下载日志已记录，仅供内部参考

分析师：邹臣
登记编码：S0730523100001
zouchen@ccnew.com 021-50581991

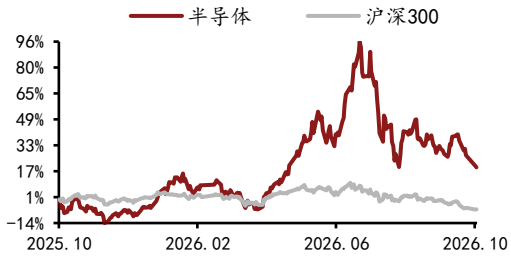
Muse 引发个人智能体应用热潮，Agentic AI 时代 CPU 重要性持续提升

——半导体行业月报

证券研究报告-行业月报　　强于大市(维持)

发布日期：2026 年 10 月 12 日

半导体相对沪深 300 指数表现



资料来源：聚源，中原证券研究所

相关报告

《半导体行业月报：半导体行业 26Q2 保持快速增长，国内存储厂商业绩表现亮眼》2026-09-15

《半导体行业月报：海外云厂商继续上调 26 年资本支出计划，服务器 CPU 需求旺盛》2026-08-11

《半导体行业月报：全球存储厂商加速扩产，关注半导体设备及零部件投资机会》2026-07-09

联系人：李智
电话： 0371-65585629
地址： 郑州郑东新区商务外环路 10 号 18 楼
地址： 上海浦东新区世纪大道 1788 号 T1 座 22 楼

投资要点：

- **9 月国内半导体行业表现相对较弱。**2026 年 9 月国内半导体行业（中信）下跌 8.83%，同期沪深 300 下跌 5.78%，其中集成电路下跌 8.37%，分立器件下跌 8.93%，半导体材料下跌 7.38%，半导体设备下跌 10.43%；半导体行业（中信）2026 年初至今上涨 33.78%。2026 年 9 月费城半导体指数上涨 9.48%，同期纳斯达克 100 上涨 3.23%，费城半导体指数 2026 年初至今上涨 78.29%。

- **全球半导体月度销售额继续同比高速增长，国内外云厂商持续加大资本支出。**2026 年 8 月全球半导体销售额同比增长 144.3%，环比增长 8%；根据 WSTS 的最新预测，预计 2026 年全球半导体销售额将达到 1.655 万亿美元，同比增长 108%。下游需求呈现结构分化趋势，AI 算力硬件基础设施需求持续旺盛，26Q2 北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊资本支出同比增长 86%，环比增长 27%，并继续上调 2026 年资本支出计划；26Q2 国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯资本开支同比增长 102%，环比增长 92%。2026 年 9 月 DRAM 现货价格环比有所分化，NAND Flash 现货价格环比小幅下降，DRAM 指数环比上涨约 2.19%，NAND 指数环比下降约 0.42%。根据 SEAJ 的数据，全球半导体设备销售额 26Q2 同比增长 23%，中国半导体设备销售额 26Q2 同比增长 5%，2026 年 8 月日本半导体设备销售额同比增长 47.4%，环比增长 7.5%；SEMI 预计 2026 年全球半导体设备销售额将增长 23.2%至 1659 亿美元。全球硅片出货量 26Q2 同比增长 7.4%，环比增长 9.1%。综上所述，我们认为目前半导体行业仍处于上行周期，AI 为推动半导体行业成长的重要动力。

- **投资建议。**近期 Muse、Dots、Instinct 等多款个人 AI 智能体陆续发布，Meta Muse 引发个人智能体应用热潮；Muse 上线后仅五天，下载量超过 ChatGPT，登顶美国 iOS 免费榜；根据 Sensor Tower 的估算，Muse 上线 22 天的下载量已突破 500 万次，同期 ChatGPT 的下载量为 230 万次。AI 智能体所需要的自主规划、多步推理、调用外部工具、连接数据库、执行代码并持续交互时，工作负载从计算密集转向控制密集、分支密集、IO 密集，GPU 负责计算，CPU 决定能否持续、高效的计算，Agentic AI 时代 CPU 重回 AI 数据中心核心。在 Advancing AI 2026 大会上，AMD CEO 苏姿丰表示，2030 年服务器 CPU 市场规模从此前 1200 亿美元上调至 2200 亿美元，2025-2030 年复合增速将超过 50%，CPU 成为 AI 基础设施的核心增量。在传统的 AI 数据中心中，CPU:GPU 比例为 1:4~1:8，智能体正驱动 CPU:GPU 比例从 1:4~1:8 转向接近 1:1，CPU 地位不断提升。AI 推理与智能体应用正重塑算力结构，CPU 重回 AI 数据中心核心，目前服务器 CPU 需求旺盛，供给紧张，有望迎来新一轮涨价潮，国产 CPU 厂商正加速实现国产替代，建议关注国产 CPU 厂商投资机会。

风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧风险，国内厂商研发

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

进展不及预期，国产化进度不及预期，国际地缘政治冲突加剧风险。

下载日志已记录，仅供内部参考

内容目录

1. 2026 年 9 月半导体行业市场表现情况 6
1.1. 9 月半导体行业股票市场表现情况 6
1.2. 9 月半导体行业可转债市场表现情况 8
1.3. 9 月半导体行业 ETF 市场表现情况 8
2. 全球半导体月度销售额继续同比高速增长，国内外云厂商持续加大资本支出 . 9
2.1. 全球半导体月度销售额继续同比高速增长 9
2.2. 2026 年全球 AI 眼镜出货量有望快速增长，AI 算力硬件基础设施需求旺盛 13
2.2.1. 全球智能手机季度出货量同比下降，预计 2026 年全球智能手机市场将有所承压 13
2.2.2. 全球 PC 季度出货量继续同比下降，预计 2026 年全球 PC 出货量大幅下降 19
2.2.3. AI 眼镜是端侧 AI 最佳硬件载体之一，2026 年全球 AI 眼镜出货量有望快速增长 23
2.2.4. 国内外云厂商持续加大资本支出，推动 AI 算力硬件基础设施需求旺盛 28
2.2.5. 中国新能源汽车月度销量同比稳健增长 29
2.3. 全球部分芯片厂商季度库存水位环比下降，国内部分芯片厂商季度库存水位环比大幅下降 30
2.4. 国内主要晶圆厂季度产能利用率环比小幅提升 31
2.5. DRAM 月度现货价格环比有所分化，NAND Flash 现货价格环比小幅下降 33
2.6. 全球半导体设备季度销售额继续同比增长，预计 2026 年有望持续增长 35
2.7. 全球硅片季度出货量继续同比增长，预计 2026 年将持续增长 37
3. 行业政策 38
4. 行业动态 39
4.1. 全球半导体行业动态 39
4.2. 河南省半导体行业动态 43
5. 估值分析与投资建议 44
5.1. 估值分析 44
5.2. 投资建议 45
6. 风险提示 45

图表目录

图 1：2026 年 9 月中信一级行业涨跌幅情况（%） 6
图 2：中信半导体指数与沪深 300 涨跌幅情况（%） 6
图 3：费城半导体指数与纳斯达克 100 涨跌幅情况（%） 7
图 4：2000-2026 年全球半导体市场销售额情况 10
图 5：2015-2026 年中国半导体市场销售额情况 10
图 6：2018-2029 年全球半导体销售额及预测情况（十亿美元） 11
图 7：2023-2027 年全球半导体各细分领域市场规模及预测情况 11
图 8：2024 年全球半导体下游应用领域占比情况 13
图 9：23Q1-26Q2 全球智能手机出货量情况 14
图 10：22Q1-26Q2 全球智能手机厂商市场份额情况 14
图 11：手机智能化演进路线图 15
图 12：AI 手机带来手机全栈革新和生态重构 15
图 13：AI 手机生态系统及主要参与者情况 16
图 14：2024-2029 年全球 AI 手机出货量及预测情况 19
图 15：23Q1-26Q2 年全球 PC 季度出货量情况 19
图 16：2016-2027 年全球 PC 出货量及预测情况 20
图 17：Canalys 对 AI PC 的定义及未来演变的考量 21
图 18：微软和英特尔对 AI PC 的定义 21
图 19：23Q4-24Q4 全球 AI PC 出货量情况 23
图 20：24Q1-25Q4 全球 PC 及 AI PC 出货量及预测 23
图 21：2024-2028 年全球 PC 市场总收入预测情况 23

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

图 22：Ray-Ban Meta 产品示意图 24
图 23：Ray-Ban Meta 产品支持耳机功能 24
图 24：AI 眼镜产品形态分类情况 24
图 25：拍照 AI 眼镜为当前主流形态 24
图 26：23Q4-24Q4 Ray-Ban Meta 眼镜出货量情况 25
图 27：小度 AI 眼镜产品示意图 25
图 28：小度 AI 眼镜产品配置及功能情况 25
图 29：华为智能眼镜 2 产品示意图 25
图 30：华为智能眼镜 2 产品示意图 25
图 31：雷鸟 V3 AI 眼镜产品示意图 26
图 32：雷鸟 X3 Pro AR 眼镜产品示意图 26
图 33：Oakley Meta HSTN AI 眼镜产品示意图 26
图 34：Oakley Meta HSTN AI 眼镜产品示意图 26
图 35：小米 AI 眼镜产品示意图 27
图 36：小米 AI 眼镜产品示意图 27
图 37：2023-2025 年全球 AI 眼镜出货量情况 27
图 38：2025 年全球及中国大陆 AI 眼镜市场竞争格局情况 28
图 39：RayBan Meta AI 眼镜系统架构框图 28
图 40：RayBan Meta AI 眼镜成本结构图 28
图 41：2020-2026 年北美四大云厂商资本开支情况（亿美元） 29
图 42：2021-2026 年国内三大互联网厂商资本开支情况（百万元） 29
图 43：2000-2026 年中国汽车销量情况 30
图 44：2015-2026 年中国新能源汽车销量情况 30
图 45：全球部分芯片厂商平均库存周转天数情况 31
图 46：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况 31
图 47：全球部分晶圆厂产能利用率情况 32
图 48： 2024-2028 年全球晶圆产能及预测情况 32
图 49： 25H2-26H2 晶圆代工价格涨幅变化情况 33
图 50：DRAM 指数走势情况 33
图 51：DRAM 现货价格走势情况（美元） 33
图 52：NAND 指数走势情况 34
图 53：NAND Flash 现货价格走势情况（美元） 34
图 54：26Q3-26Q4 DRAM 及 NAND Flash 产品合约价格预测情况 34
图 55： 26H2 各类 NOR Flash 产品供需、价格趋势情况 35
图 56：2005-2026 年全球半导体设备销售额情况 35
图 57：2005-2026 年中国半导体设备销售额情况 35
图 58：日本半导体设备月度销售额情况 36
图 59：2024-2028 年全球半导体设备销售额及预测按细分市场划分情况 36
图 60： 2024-2028 年全球晶圆厂设备销售额及预测按应用划分情况 37
图 61：全球硅片出货量情况 38
图 62：2022-2027 年全球硅片出货量情况及预测 38
图 63：近十年半导体（申万）PE Bands 45

表 1：2026 年 9 月 A 股中信半导体行业部分个股涨跌幅情况 6
表 2：2026 年 9 月美股主要半导体公司涨跌幅情况 8
表 3：2026 年 9 月国内半导体行业可转债涨跌幅情况（截至 2026 年 9 月 30 日） 8
表 4：2026 年 9 月国内半导体行业 ETF 涨跌幅情况（截至 2026 年 9 月 30 日） 9
表 5：全球前十五大芯片公司 26Q2 营收情况及 26 年展望 12
表 6：全球部分处理器厂商发布的支持端侧型手机的 SoC 芯片情况 16
表 7：全球部分智能手机厂商旗舰机布局情况 17
表 8：26Q2 全球 PC 厂商市场份额情况 20
表 9：全球主要处理器厂商发布的适用于 AI PC 处理器情况 21
表 10：全球部分 PC 厂商 AI PC 布局情况 22

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

表 11：近年美日荷对中国半导体产业部分制裁政策情况..... 39

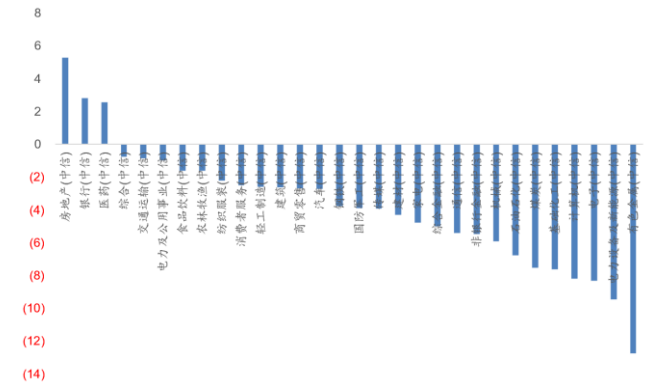
下载日志已记录，仅供内部参考

1. 2026 年 9 月半导体行业市场表现情况

1.1. 9 月半导体行业股票市场表现情况

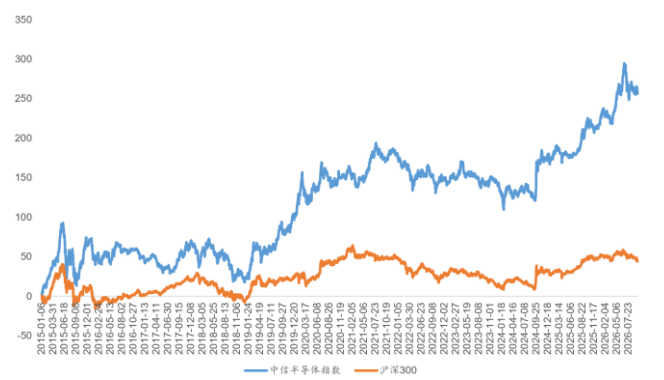
2026 年 9 月 A 股半导体行业表现相对较弱，走势弱于沪深 300。2026 年 9 月电子行业（中信）下跌 8.31%，9 月沪深 300 下跌 5.78%，电子行业表现弱于沪深 300 指数。半导体行业（中信）2026 年 9 月下跌 8.83%，表现大幅弱于沪深 300，其中集成电路下跌 8.37%，分立器件下跌 8.93%，半导体材料下跌 7.38%，半导体设备下跌 10.43%；半导体行业（中信）2026 年初至今上涨 33.78%。

图 1：2026 年 9 月中信一级行业涨跌幅情况（%）



资料来源：Wind，中原证券研究所

图 2：中信半导体指数与沪深 300 涨跌幅情况（%）



资料来源：Wind，中原证券研究所

2026 年 9 月半导体板块上涨家数远少于下跌家数，2026 年 9 月涨幅排名前十的公司分别为先导基电（40%）、利扬芯片（32%）、恒运昌（26 %）、气派科技（20%）、高凯技术（19%）、慧智微-U（18%）、富乐德（15%）、博通集成（14%）、聚辰股份（13%）、先锋精科（12%）。

表 1：2026 年 9 月 A 股中信半导体行业部分个股涨跌幅情况

证券代码	证券名称	总市值（亿元）	9 月涨跌幅（%）	年初至今涨跌幅（%）	市盈率（TTM）	市销率（TTM）	市净率
600641.SH	先导基电	461	40	175	1,078	20	5
688135.SH	利扬芯片	85	32	31	643	12	5
688785.SH	恒运昌	235	26	-6	242	47	11
688216.SH	气派科技	43	20	70	-904	5	6
688835.SH	高凯技术	340	19	45	184	57	40
688512.SH	慧智微-U	80	18	46	-27	9	5
301297.SZ	富乐德	336	15	34	61	8	6
603068.SH	博通集成	68	14	20	127	6	4
688123.SH	聚辰股份	254	13	28	37	20	8
688605.SH	先锋精科	162	12	25	117	13	10
688381.SH	帝奥微	102	12	82	133	21	4
603893.SH	瑞芯微	912	11	22	67	17	19
003026.SZ	中晶科技	61	11	53	104	13	9
688209.SH	英集芯	138	11	60	60	8	6
688486.SH	龙迅股份	88	9	-10	48	14	6
002119.SZ	康强电子	97	8	7	80	4	7
002077.SZ	大港股份	79	8	-8	105	19	2
300623.SZ	捷捷微电	269	6	18	51	7	4
688801.SH	燧原科技-U	1,809	6	6	-153	100	68

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

688536.SH	思瑞浦	452	6	105	109	16	7
688498.SH	源杰科技	2,008	5	264	267	152	64
688130.SH	晶华微	31	4	23	-147	15	3
688432.SH	有研硅	589	4	280	249	50	13
605358.SH	立昂微	350	4	31	511	9	3
688809.SH	强一股份	633	4	91	132	50	15
688608.SH	恒玄科技	260	3	-32	56	9	4
000670.SZ	盈方微	62	3	-1	-93	1	190
688035.SH	德邦科技	102	3	49	78	6	4
603160.SH	汇顶科技	248	3	-32	38	5	3
600360.SH	华微电子	104	3	36	57	4	3
301319.SZ	唯特偶	149	-22	115	168	8	12
688206.SH	概伦电子	182	-23	-1	-977	36	9
688372.SH	伟测科技	169	-24	-8	47	8	4
688141.SH	杰华特	432	-24	119	-46	14	40
688795.SH	摩尔线程-U	1,852	-26	-33	-250	73	15
688146.SH	中船特气	1,009	-27	372	196	32	17
688702.SH	盛科通信-U	1,168	-27	101	-812	89	52
301666.SZ	大普微-UW	1,483	-27	39	123	24	41
003043.SZ	华亚智能	86	-27	31	92	8	4
688802.SH	沐曦股份-U	1,989	-28	-14	22,355	97	14

资料来源：Wind，中原证券研究所

2026 年 9 月费城半导体指数表现强于纳斯达克 100。2026 年 9 月费城半导体指数上涨 9.48%，9 月纳斯达克 100 上涨 3.23%，费城半导体指数走势强于纳斯达克 100；费城半导体指数 2026 年初至今上涨 78.29%。

图 3：费城半导体指数与纳斯达克 100 涨跌幅情况（%）



资料来源：Wind，中原证券研究所

2026 年 9 月美股半导体板块上涨家数远多于下跌家数，2026 年 9 月涨幅排名前十的公司分别为 MaxLinear（51%）、FormFactor（48%）、科休半导体（48%）、英特尔（34%）、先科电子（34%）、南茂（31%）、Ceva（31%）、超威半导体（30%）、AXT（28%）、思佳讯（28%）。

下载日志已记录，仅供内部参考

表 2：2026 年 9 月美股主要半导体公司涨跌幅情况

证券代码	证券名称	总市值（亿美元）	9 月涨跌幅（%）	年初至今涨跌幅（%）	市盈率（TTM）	市销率（TTM）	市净率
MXL.O	MaxLinear	82	51	418	(79)	14	17
FORM.O	FormFactor	117	48	168	101	13	10
COHU.O	科休半导体	32	48	193	(83)	6	4
INTC.O	英特尔	6355	34	226	(56)	11	7
SMTC.O	先科电子	166	34	142	108	14	22
IMOS.O	南茂	25	31	145	35	3	3
CEVA.O	Ceva	10	31	64	(91)	9	3
AMD.O	超威半导体	9987	30	186	155	24	15
AXTI.O	AXT	51	28	373	1280	40	5
SWKS.O	思佳讯	129	28	38	44	3	2
AEHR.O	Aehr Test Systems	33	26	393	(457)	65	15
MRVL.O	迈威尔科技	2317	25	211	88	25	13
UMC.N	联电	614	23	216	24	8	4
RMBS.O	Rambus	116	23	16	48	15	8
ASX.N	日月光投控	994	20	178	52	4	8
MX.N	美格纳半导体	1	20	47	(4)	1	1
ALAB.O	Astera	618	20	114	167	51	36
ARM.O	Arm Holdings	3094	20	165	296	60	36
UCTT.O	超科林半导体	37	20	220	(157)	2	6
QRVO.O	Qorvo	101	19	35	25	3	3
UCTT.O	超科林半导体	31	(19)	168	(131)	1	5
AMBA.O	安霸	30	(19)	(2)	(44)	8	5
ATOM.O	Atomera	2	(19)	88	(7)	706	4
MOBX.O	Mobix Labs	0.2	(21)	(51)	(0)	4	3
SEDG.O	Solaredge	20	(22)	12	(7)	1	5
AOSL.O	阿尔法和欧米伽半导体	7	(22)	24	(18)	1	1
AIP.O	Arteris	11	(27)	41	(27)	13	16
ICHR.O	Ichor Holdings	20	(29)	191	(50)	2	2
LASR.O	nLIGHT	24	(39)	13	(195)	8	6
SMTK.O	SmartKem	0.02	(71)	(94)	(0)	3	0

资料来源：iFinD，中原证券研究所

1.2. 9 月半导体行业可转债市场表现情况

2026 年 9 月国内半导体行业可转债全面下跌。

表 3：2026 年 9 月国内半导体行业可转债涨跌幅情况（截至 2026 年 9 月 30 日）

代码	证券名称	评级	余额（亿元）	剩余期限（年）	转股溢价率（%）	2026 年 9 月涨跌幅（%）	2026 年初至今涨跌幅（%）	现价
113616.SH	韦尔转债	AA+	24.32	0.24	111.92	0.00	-12.50	109.56
118036.SH	力合转债	AA-sti	3.80	2.74	29.31	-3.19	6.39	140.71
118015.SH	芯海转债	A+sti	4.10	1.81	129.74	-3.54	0.71	124.06
127038.SZ	国微转债	AA+sti	14.91	0.69	86.60	-3.94	-15.11	111.33
123122.SZ	富瀚转债	A+	5.80	0.85	42.62	-4.00	5.75	125.95
118059.SH	颀中转债	AA+sti	8.50	5.09	51.84	-5.35	28.47	190.42
110081.SH	闻泰转债	BBB-	71.50	0.82	13.30	-6.18	-11.79	101.39
123124.SZ	晶瑞转 2	A+sti	5.22	0.88	35.17	-7.22	-4.40	130.20
118071.SH	华峰转债	AAsti	7.49	5.73	87.19	-8.01	108.78	208.78
118070.SH	南芯转债	AA+	15.87	5.72	96.65	-10.28	10.85	144.10
118056.SH	路维转债	AA-	6.14	4.70	40.74	-14.02	30.68	255.24
123255.SZ	鼎龙转债	AA	9.10	4.50	36.00	-18.99	78.19	323.24

资料来源：Wind，中原证券研究所

1.3. 9 月半导体行业 ETF 市场表现情况

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

2026 年 9 月国内半导体行业 ETF 全面下跌。

表 4：2026 年 9 月国内半导体行业 ETF 涨跌幅情况（截至 2026 年 9 月 30 日）

代码	证券名称	上市日期	现有规模（亿元）	2026 年 9 月涨跌幅（%）	2026 年初至今涨跌幅（%）
513310.SH	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体 ETF	2022/12/22	113.05	-2.47	82.27
159325.SZ	南方中证半导体行业精选 ETF	2024/11/8	11.13	-9.15	31.66
159665.SZ	工银瑞信国证半导体芯片 ETF	2023/1/6	5.61	-9.45	24.89
159801.SZ	广发国证半导体芯片 ETF	2020/2/18	47.61	-9.51	22.17
588200.SH	嘉实上证科创板芯片 ETF	2022/10/26	475.78	-9.55	38.30
512760.SH	国泰 CES 半导体芯片 ETF	2019/6/12	99.03	-9.56	25.09
588170.SH	华夏上证科创板半导体材料设备主题 ETF	2025/4/8	419.46	-9.63	81.40
589020.SH	鹏华科创板半导体材料设备主题 ETF	2025/9/4	50.83	-9.64	81.84
588710.SH	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF	2025/6/4	104.75	-9.70	80.94
512480.SH	国联安中证全指半导体 ETF	2019/6/12	192.46	-9.74	30.46
159813.SZ	鹏华国证半导体芯片 ETF	2020/5/25	62.46	-9.76	21.73
159582.SZ	博时中证半导体产业 ETF	2024/4/16	7.55	-9.84	55.32
159995.SZ	华夏国证半导体芯片 ETF	2020/2/10	259.34	-9.85	21.55
159516.SZ	国泰中证半导体材料设备主题 ETF	2023/7/27	394.70	-9.96	68.68
159558.SZ	易方达中证半导体材料设备主题 ETF	2024/6/18	195.11	-10.12	69.13
561980.SH	招商中证半导体产业 ETF	2023/9/1	53.99	-10.16	54.15
562590.SH	华夏中证半导体材料设备主题 ETF	2023/10/18	82.58	-10.17	70.02
159327.SZ	万家中证半导体材料设备主题 ETF	2024/8/5	28.03	-10.24	70.33
560780.SH	广发中证半导体材料设备主题 ETF	2023/12/12	119.03	-10.30	69.26

资料来源：Wind，中原证券研究所

2. 全球半导体月度销售额继续同比高速增长，国内外云厂商持续加大资本支出

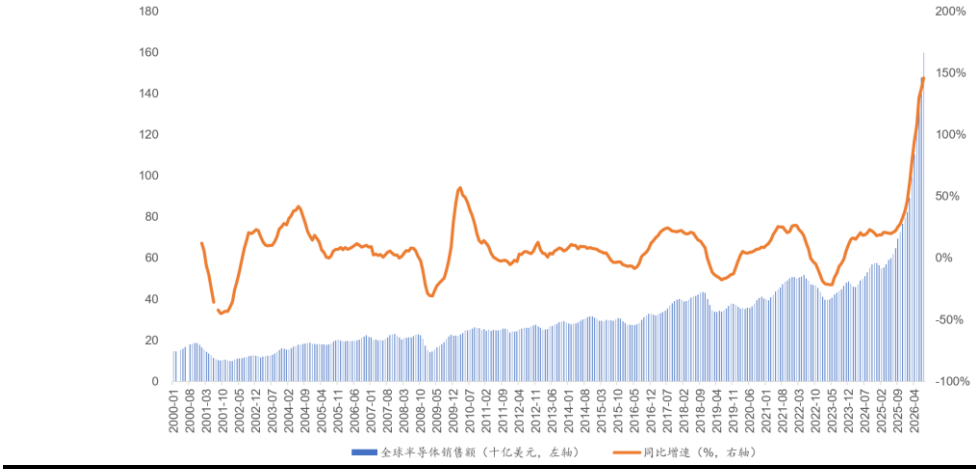
2.1. 全球半导体月度销售额继续同比高速增长

2026 年 8 月全球半导体销售额同比增长 144.3%，环比增长 8%。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2026 年 8 月份全球半导体销售额约为 1597 亿美元，同比增长 144.3%，连续 34 个月实现同比增长，环比增长 8%；2026 年前 8 个月累计销售额已突破 1 万亿美元。2026 年 8 月，从区域表现来看，同比增长上，增幅最大的美洲市场上涨 180.9%，亚太其他地区增长 143.0%，中国市场增长 131.3%，欧洲增长 98.5%，日本增长 62.3%；环比增长上，亚太其他地区增长 9.1%，日本增长 8.5%，美洲增长 8.2%，欧洲增长 7.5%，中国增长 6.6%。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

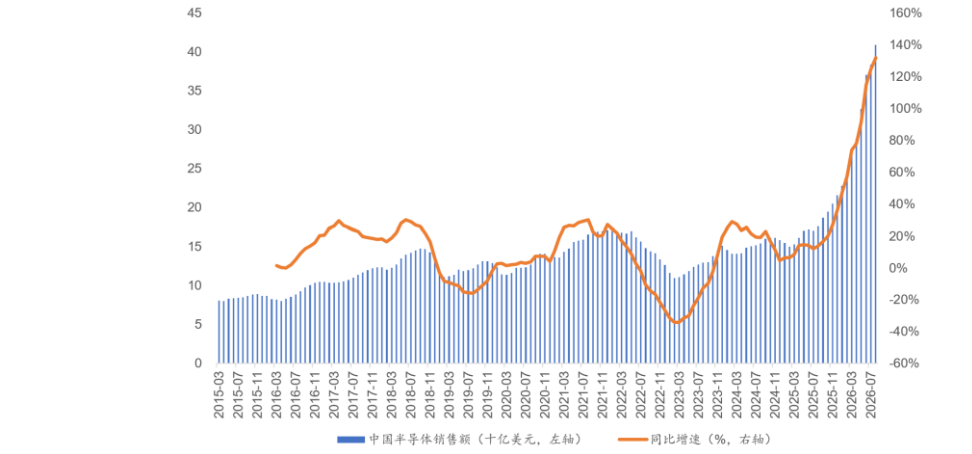
图 4：2000-2026 年全球半导体市场销售额情况



资料来源：SIA，Wind，中原证券研究所

2026 年 8 月中国半导体销售额同比增长 131.3%，环比增长 6.6%。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2026 年 8 月中国半导体行业销售额为 409 亿美元，同比增长 131.3%，连续 34 个月实现同比增长，环比增长 6.6%。

图 5：2015-2026 年中国半导体市场销售额情况



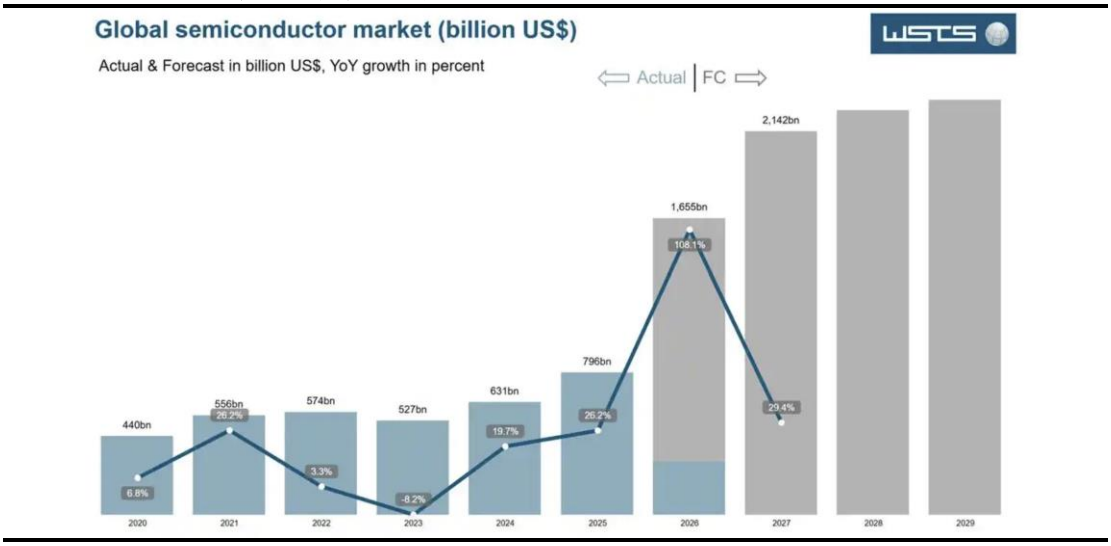
资料来源：SIA，Wind，中原证券研究所

WSTS 预计 2026 年全球半导体销售额将同比增长 108%。根据 WSTS 的数据，2026 年上半年全球半导体市场规模达到 7020 亿美元，同比增长 102%，其中存储器同比增长 305%、逻辑电路同比增长 45%。WSTS 预计 2026 年全球半导体市场规模达到 1.655 万亿美元，同比增长 108%，预计半导体市场 2027 年继续同比增长 29%，市场规模将达到 2.1 万亿美元。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

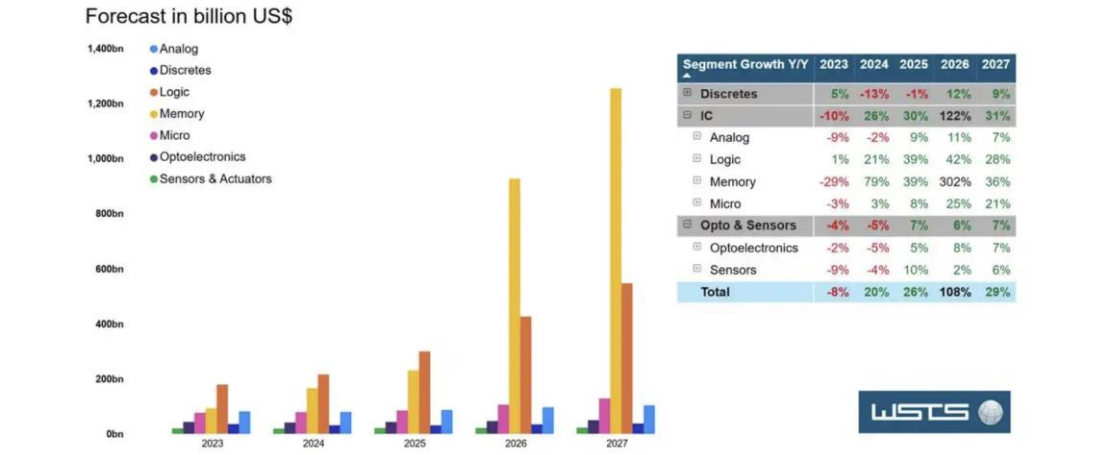
图 6：2018-2029 年全球半导体销售额及预测情况（十亿美元）



资料来源：WSTS，中原证券研究所

存储器和逻辑芯片是驱动全球半导体市场增长的主要动力。根据 WSTS 的预测，预计存储器细分领域 2026 年销售额同比增幅将达 302%，2027 年预计仍将增长 36%；预计逻辑芯片 2026 年销售额将实现 42%增幅，预计 2027 年继续增长 28%；预计微处理器 2026 年销售额同比增长 25%，2027 年继续增长 21%；预计模拟芯片 2026 年销售额同比增长 11%，2027 年继续增长 7%；预计分立器件 2026 年销售额同比增长 12%，2027 年继续增长 9%。

图 7：2023-2027 年全球半导体各细分领域市场规模及预测情况



Segment Growth Y/Y	2023	2024	2025	2026	2027
Discretes	5%	-13%	-1%	12%	9%
IC	-10%	26%	30%	122%	31%
Analog	-9%	-2%	9%	11%	7%
Logic	1%	21%	39%	42%	28%
Memory	-29%	79%	39%	302%	36%
Micro	-3%	3%	8%	25%	21%
Opto & Sensors	-4%	-5%	7%	6%	7%
Optoelectronics	-2%	-5%	5%	8%	7%
Sensors	-9%	-4%	10%	2%	6%
Total	-8%	20%	26%	108%	29%

资料来源：WSTS，中原证券研究所

全球存储器厂商 26Q2 业绩继续表现亮眼，服务器 CPU 需求旺盛。近期部分全球 15 大芯片厂商公布了 26Q2 季报，受益于 AI 推理对于存储用量大幅提升，推动 HBM、DDR5 及企业级 SSD 需求增长，存储器厂商三星、SK 海力士、美光、铠侠 26Q2 业绩继续实现同环比高速增长；目前 DRAM、NAND 供应紧张，预计 2026 年存储需求将继续快速增长。随着 AI 工作负载从训练转向推理、智能体，CPU 在 AI 数据中心中的地位逐步提升，英特尔与 AMD 服务器 CPU 出货量 26 年实现强劲增长。TI、NXP、ST、英飞凌受益于数据中心需求加速，工业、汽车等领域需求恢复，模拟芯片 26Q2 继续复苏。

下载日志已记录，仅供内部参考

表 5：全球前十五大芯片公司 26Q2 营收情况及 26 年展望

	公司	26Q2 营收（亿美元）	26Q2 同比增速	26Q2 环比增速	26Q3 环比增速指引	2026 年展望
1	英伟达	962	106%	18%	+12%	英伟达预计 26Q3 公司营收将达 1080 亿美元，上下浮动 2%，中位值同比增长 89%，环比增长 12%,毛利率约为 74%。AI 需求激增推动全球持续加大基础设施建设，公司预计 2028 财年营收同比增长约 70%，并且该预期受到供给约束。
2	三星半导体	906	357%	56%	-	三星预计 26H2 服务器 DRAM 与 SSD 需求预计持续强劲，智能体 AI 加速需求增长，持续提升 DDR5、SOCAMM2 等高附加值 AI 产品占比，以高性能产品主导 PCIe Gen6 企业级 SSD 市场，聚焦 KV 缓存。
3	SK 海力士	555	257%	51%	-	海力士预计 26Q3 DRAM 出货量环比增长约 10%，NAND 出货量环比增长低个位数。公司已与约 10 家客户签订 LTA，合同期限通常约为五年，不同客户、不同产品对应不同的定价机制。
4	美光	415	346%	74%	+21%	美光预计 26Q3 营收为 490-510 亿美元，中位值同比 +342%、环比+21%，毛利率预计为 86%。公司预计 DRAM 与 NAND 的供需紧张格局将持续至 2027 年之后，预计 2026 年 DRAM 位元出货量将增长低到中 20%，NAND 位元出货量将增长约 20%，预计 2026 年供应将持续紧张。预计 2026 财年资本支出将达 270 亿美元，预计 2027 年资本支出将继续增长。
5	博通	296	86%	33%	+18%	博通预计 26Q3 营收约为 348 亿美元，同比增长 93%，环比增长 18%。公司将 2026 财年 AI 收入指引上调至 580 亿美元，预计 2027 财年将达 1150 亿美元，预计 2028 财年继续增长至 2300 亿美元。
6	英特尔	161	25%	19%	+%	英特尔预计 26Q3 营收 158-168 亿美元，中值同比 +19%、环比+1%。随着 AI 工作负载从训练转向推理、智能体，CPU 在 AI 基础设施中的结构性地位更加重要，26Q2 公司签署多份 LTA；公司预计服务器 CPU 出货量今明两年将实现强劲增长，景气周期将延续至 2028 年。
7	AMD	115	50%	13%	+41%	AMD 预计 26Q3 营收为 127-133 亿美元，中位值同比 +41%、环比+13%，毛利率约为 56%。AMD 预计数据中心销售将在 2026 年下半年进一步加速，推动整体收入增长和利润扩张；预计 2027 年数据中心销售将翻倍，并计划推出配备 MI500 GPU、Verano CPU 及 Pensando 网络技术的机架级产品。
8	铠侠	111	416%	76%	+35%	铠侠预计 26Q3 营收为 2.39 万亿日元，环比增长 35.3%。AI 数据中心 NAND 需求是核心驱动力，2026 财年产能已基本售罄，供需紧张支撑高位价格。NAND 市场已脱离传统周期性，转向更稳定的增长轨道，公司目标将约 50% 出货量通过多年 LTA 锁定。
9	高通（IC）	85	-5%	-6%	+2%	高通 26Q2 汽车业务强劲，但手机业务疲软拖累整体表现。预计 26Q3 QCT 芯片业务营收 84–90 亿美元，中位值环比增长 2%，手机芯片业务受秋季新机备货启动导致需求边际改善，汽车及 IoT 业务持续增长，但内存供应短缺和成本压力仍影响公司整体增速。
10	TI	55	23%	13%	+%	TI 预计 26Q3 营收 56.5-61.5 亿美元，中值同比+33%、环比+8%。26Q2 数据中心业务营收同比翻倍、环比增长约 20%，工业业务营收同比增长约 30%、环比增长约 10%，汽车业务营收实现同比中双位数增长。公司预计工业和汽车市场的复苏势头有望在 26H2 延续，AI 数据中心相关需求将继续成为重要增长动力。
11	联发科	48	2%	3%	+3%	联发科预计 26Q3 营收为 1522 -1598 亿元新台币，中位值同比+9.8%、环比+2.5%，毛利率为 46%；26Q2 呈现 AI 数据中心需求强劲、手机芯片需求疲软的分化格局；公司正通过涨价应对成本压力，并将数据中心 AI ASIC 作为公司核心增长引擎。
12	英飞凌	48	13%	9%	+13%	英飞凌预计 26Q3 营收约 47 亿欧元，环比+13%。展望 2026 财年，AI 数据中心电源业务处于供不应求状态，成

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

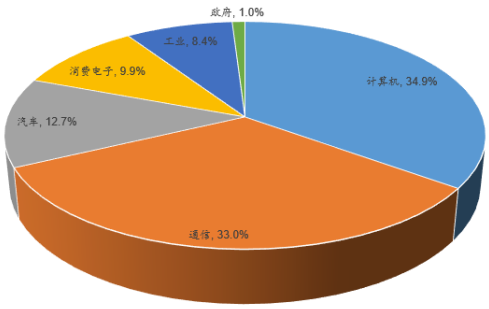
						为最核心的增长引擎，上调全年营收目标至 163 亿欧元。
13	ADI	40	40%	11%	+7%	ADI 预计 26Q3 营收 42-44 亿美元，中值同比+49.5%、环比+6.9%。26Q2 所有终端市场均实现增长，数据中心和工业领域表现尤为突出，AI 基础设施投资将是未来数年增长的核心驱动力。
14	恩智浦	35	+19%	+10%	+7%	恩智浦预计 26Q3 营收为 36.5-38.5 亿美元，中值同比+18%、环比+7%，毛利率为 58.5%。26Q2 公司所有终端市场和区域均实现增长，人工智能正从云端走向汽车、工业和机器人，而这些应用场景正是恩智浦长期保持领先地位的核心市场。
15	意法半导体	35	26%	13%	+6%	ST 预计 26Q3 营收中值为 37 亿美元，中值同比+16%、环比+6%；毛利率约为 37%。26Q2 通信设备与计算机外设业务营收同比+50%，工业业务营收同比+34%，个人电子产品营收同比+20%，汽车业务营收同比+16%。公司看好后续市场需求，多个品类出现供应趋紧迹象。

资料来源：各公司公告，中原证券研究所

2.2. 2026 年全球 AI 眼镜出货量有望快速增长，AI 算力硬件基础设施需求旺盛

全球半导体下游需求呈现结构性特征，消费类需求占比较高。根据 SIA 的数据，2024 年全球半导体下游应用领域中计算机占比 34.9%、通信占比 33.0%、汽车占比 12.7%、消费电子占比 9.9%、工业占比 8.4%、政府占比 1%。消费类下游占比较高，目前 AI 算力硬件需求持续旺盛，工业市场需求开始复苏。

图 8：2024 年全球半导体下游应用领域占比情况



资料来源：SIA，中原证券研究所

2.2.1. 全球智能手机季度出货量同比下降，预计 2026 年全球智能手机市场将有所承压

26Q2 全球智能手机出货量同比下降 6%。根据 Omdia 的数据，2026 年第二季度全球智能手机出货量同比下降 6%，降至 2.72 亿部。2026 年第一季度受提前备货需求带动，市场表现较强，而第二季度则进入存储器成本周期的调整阶段。持续高企的存储价格扰乱了供应，推高了元器件成本，迫使厂商重新思考定价策略、产品组合和渠道战略。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

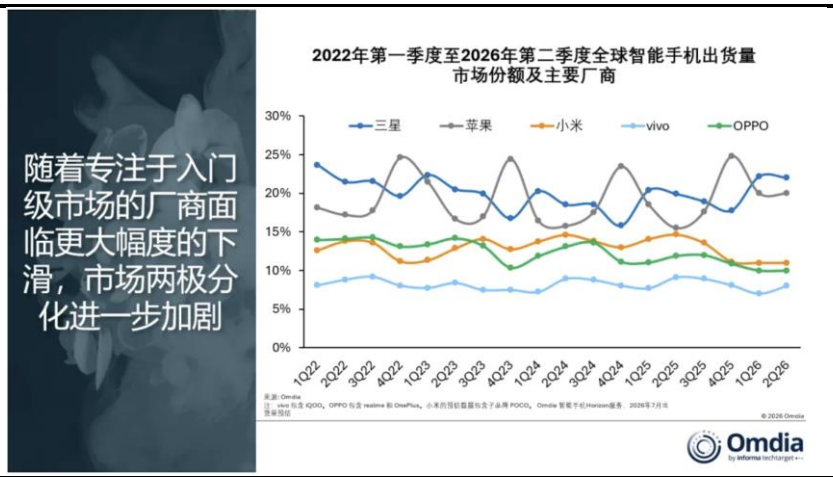
图 9：23Q1-26Q2 全球智能手机出货量情况



资料来源：Omdia，中原证券研究所

26Q2 三星、苹果、小米、OPPO、vivo 市场份额位列前五位。根据 Omdia 的数据，2026 年第二季度，三星保持全球份额第一地位，出货量达 6050 万部，同比增长 5%，市场份额为 22%；苹果实现了有史以来最强劲的第二季度表现，出货量达 5510 万部，同比增长 23%，在传统淡季创下 20%的市场份额纪录；小米以 3120 万部出货量保持第三位，同比下降 26%，连续第二个季度下滑，小米是前五大厂商中受存储成本上涨影响最大的，特别是在亚太和拉丁美洲新兴市场，入门级产品涨价严重影响了需求；OPPO 排名第四，出货量为 2840 万部，同比下降 17%，OPPO 精简了旗下三个子品牌的市场组合，并减少了入门级 SKU 以提高盈利能力；vivo 以 2150 万部出货量位列第五，同比下降 18%。

图 10：22Q1-26Q2 全球智能手机厂商市场份额情况



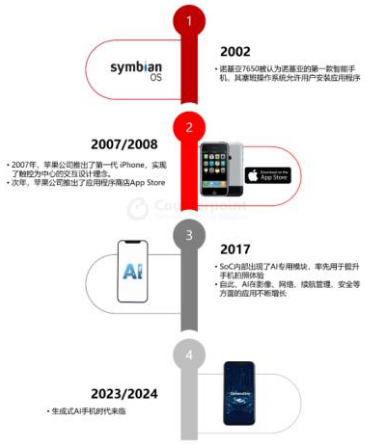
受益于 AI 大模型的赋能，智能手机将迎来 AI 新时代。通过 AI 技术赋能智能手机可以追溯至 2017 年，安卓厂商开始在其 SoC 平台中加入独立的 AI 计算单元，用于运行和影像增强相关的深度学习模型，随后 AI 技术逐渐被手机厂商用于更多方面，如强化安全、优化续航、提升网络性能等，但计算、摄影一直是其最主要的应用领域，直到大模型被装进智能手机，手机 AI 应用从中小模型时代跨越至大模型时代。有了大模型的加持，在人机交互层面，新的多模态交互将取代传统的触控屏交互，用户可以更自然的与手机沟通；多模态输入和输出能力相结合，可以极大强化智能手机的生产力工具属性，既可以基于多种形式的输入信息，生成用户

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

需要的图表、文本、音乐、图片甚至是视频，也可以对输入的图片、视频进行编辑。

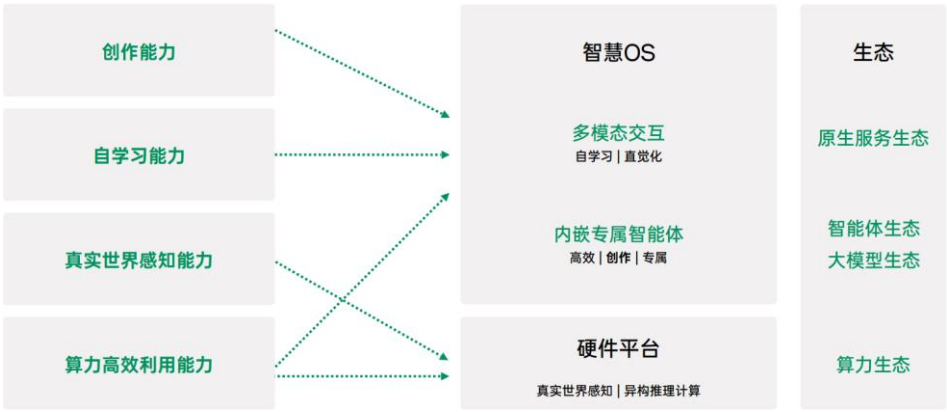
图 11：手机智能化演进路线图



资料来源：生成式 AI 手机产业白皮书（Counterpoint，联发科等），中原证券研究所

AI 手机可以通过端侧部署 AI 大模型实现多模态内容生成、情境感知，能更自然的进行交互，并内嵌专属智能体。AI 手机应具有创作能力、自学习能力、真实世界感知能力、算力高效利用能力。

图 12：AI 手机带来手机全栈革新和生态重构



资料来源：AI 手机白皮书（IDC，OPPO），中原证券研究所

生成式 AI 将成为智能手机厂商的重要战略，行业领导者引领 AI 技术。随着三星发布全新的 Galaxy S24 智能手机，三星将生成式 AI 作为长期的产品策略，同时中国厂商小米、vivo、OPPO 和荣耀等也已发布具备生成式 AI 能力的旗舰机型。AI 逐步从最初的产品层面的差异化上升至运营及公司层面的整体战略，各智能手机厂商均涉及其中。苹果、谷歌和三星等全球主要厂商以及荣耀、OPPO、小米和 vivo 等中国领先厂商都走在将生成式 AI 功能集成到其设备的前列；其战略各不相同，从开发专用 AI 芯片到加强利用 AI 的生态系统集成来提升用户体验。

下载日志已记录，仅供内部参考

图 13：AI 手机生态系统及主要参与者情况



资料来源：Canalys，中原证券研究所

高通、联发科不断迭代支持端侧 AI 大模型手机的 SoC 芯片，NPU 算力不断提升。2025 年 9 月 25 日，高通正式发布新一代旗舰芯片骁龙 8 Elite Gen 5，延续 2+6 核心架构，两个 Prime 核心频率提升至 4.6GHz，六个性能核心运行于 3.62GHz；比前代产品，CPU 性能提升 20%，能效提升 35%，整体功耗降低 16%；图形处理方面，新一代 Adreno GPU 采用切片式架构，整体 GPU 性能提升 23%，功耗降低 20%；AI 性能显著增强，Hexagon NPU 速度提升 37%，支持 INT2 精度量化，可在设备端运行更复杂的大语言模型。2025 年 9 月 22 日，联发科正式发布天玑 9500 旗舰手机处理器，天玑 9500 全大核 CPU 架构包含 1 个主频高达 4.21GHz 的 C1-Ultra 超大核、3 个 C1-Premium 超大核和 4 个 C1-Pro 大核，物体侦测运算性能提升 57%、运行编解码模型功耗下降 50%；搭载新一代旗舰 GPU G1-Ultra，其峰值性能相较上一代提升 33%，功耗相较上一代峰值性能下降低 42%，光线追踪渲染性能较上一代提升 119%；集成全新超性能和超能效双 NPU，超性能 NPU 990 峰值性能相较上一代提升 111%，在大语言模型摘要输出能力、多模态理解能力皆有大幅跃进，并率先实现 4K 高清画质文生图，同时 NPU 990 相较上一代在峰值性能下的功耗降低 56%。

表 6：全球部分处理器厂商发布的支持端侧 AI 大模型手机的 SoC 芯片情况

厂商	处理器	发布时间	CPU	GPU	NPU AI 算力	存储器	制程
高通	骁龙 8 Gen 3	2023.10	骁龙 8 Gen 3	Adreno750 GPU	支持 100 亿参数的 AI 大模型	LPDDR5X	4nm
高通	骁龙 8 Elite	2024.10	Oryon CPU	Adreno 830	80 TOPS	LPDDR5X	3nm
高通	骁龙 8 Elite Gen 5	2025.9	Oryon CPU，8 核心（2+6）	Adreno 840	-	LPDDR5X	3nm
联发科技	天玑 9300	2023.11	8 核心，4 个 Cortex-X4、4 个 Cortex-A720，最高主频 5.2GHz	12 核 Arm Immortalis-G720 MC12 GPU	支持 330 亿参数的 AI 大模型	LPDDR5T	4nm
联发科技	天玑 9400	2024.9	8 核心，1 个 Cortex-X925，3 个 Cortex-X4、4 个 Cortex-A720	12 核 Arm Immortalis-G925 GPU	MediaTek NPU 890	LPDDR5X	3nm
联发科技	天玑 9500	2025.9	8 核心，1 个 C1-Ultra 超大核、3 个 C1-Premium 超大核，4 个 C1-Pro 大核	I-Ultra	集成全新超性能和超能效双 NPU，NPU 990	LPDDR5X	3nm
苹果	A18	2024.9	6 核心，2 个性能核心和 4 个效率核心，主	5 核 GPU	35 TOPS	LPDDR5X	3nm

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

			频分别为 4.05GHz 和 2.42GHz				
苹果	A19/Pro	2025.9	6 核心	6 核 GPU	-	LPDDR5X	3nm

资料来源：各公司官网，中原证券研究所

手机厂商持续迭代 AI 手机。随着三星发布全新的 Galaxy S24 智能手机，三星将生成式 AI 作为长期的产品策略，同时中国厂商华为、小米、vivo、OPPO 和荣耀等也陆续发布并持续迭代 AI 手机。目前安卓手机厂商旗舰机型的 AI 功能主要支持通话实时翻译、通话及会议摘要、语音识别与文本生成、AI 写作、AI 修图等，AI 功能仍为基础性应用。

表 7：全球部分智能手机厂商旗舰 AI 手机布局情况

厂商	型号	发布时间	处理器	存储器	大模型	参数量	AI 功能
苹果	iPhone16/ Pro/ Max	2024.9	苹果 A18/ Pro	8GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	自有模型及第三方模型	-	支持 Apple Intelligence。
苹果	iPhone17/ Air / Pro/ Max	2025.9	苹果 A19/ Pro	12GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	自有模型及第三方模型	-	支持 Apple Intelligence。
苹果	iPhone18Pro/ Max/Duo	2026.9	苹果 A20 Pro	12GB LPDDR5X，最高 2TB 存储空间	自有模型及第三方模型	-	支持 Apple Intelligence。
三星	Galaxy S24/ Plus/Ultra	2024.1	骁龙 8 Gen 3	12GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	谷歌 Gemini Nano	1.8B/3.25B	支持通话实时翻译、写作助手、转录助手、智能修图、利用 AI 改善成像效果的 AI 图像处理器等。
三星	Galaxy S25/ Plus/Ultra	2025.1	骁龙 8 至尊版	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	谷歌 Gemini Nano，DeepSeek-R1	-	支持深度思考与联网搜索；搭载升级的 Galaxy AI，支持即圈即搜、写作助手和更为智能的翻译功能，支持 AI 影像优化等。
三星	Galaxy S26/ Plus/Ultra/Z Fold8 Ultra	2026.3/7	骁龙 8 Elite Gen5	12GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	谷歌 Gemini Nano	-	支持跨 40 多款应用的扩展任务自动化、Now Nudge（屏幕内容智能建议）和 Photo Assist（AI 照片编辑）等。
华为	Mate70/ Pro	2024.11	麒麟 9010/9020	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	支持 AI 运动轨迹、AI 主角时刻、AI 时空穿越、AI 智控键、AI 隔空传送、AI 通话摘要、AI 消息随身、AI 降噪通话、AI 静谧通话。
华为	Mate80/ Pro	2025.11	麒麟 9020/9030	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	支持全新小艺智能助手，支持自主学习与技能生成、任务自动化、购物场景优化、系统级整合等功能；支持 AI 魔法系列的图像视频创作等。
华为	Pura90/ Mate XT2	2026.4/9	麒麟 9030S/9050 Pro	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	支持全新小艺智能助手，支持具备记忆、反思、任务规划，跨 App 自动完成多步骤任务。
小米	小米 15	2024.10	骁龙 8 Elite	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	小米 MiLM2	0.3B-30B	支持超级小爱助手、AI 写作、AI 字幕、AI 妙画、语音识别与文本生成、全局实时翻译等。

下载日志已记录，仅供内部参考

小米	小米 15 Ultra	2025.2	骁龙 8 至尊版	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	支持 AI 影像系统，可实现 AI 动态人像壁纸、AI 融合变焦、智能拍摄优化功能；支持 AI 绘画与文本生成功能、AI 助手与语音识别等。
小米	小米 17/ Pro/ Max	2025.9	第五代骁龙 8 至尊版	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	以“AI 生态融合”为核心定位，依托澎湃 OS 3.0 与硬件级 AI 算力支撑，构建了覆盖交互、影像、创作、跨设备协同等多场景的 AI 功能体系。
小米	小米 18/Pro/ Max/Fold	2026.9	骁龙 8 至尊版/玄戒 O3	16GB LPDDR5X，最高 2TB 存储空间	-	-	支持全套超级小爱 2.0、灵感球、AI 百变背屏、文档摘要、影像 AI、会议录音 AI、超级岛等。
OPPO	Find X8	2024.10	天玑 9400	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	OPPO AndesGPT	7B	支持 SenseNow 智慧框架、AI 私密计算云、AI 修图功能、AI 超清像素、AI 千里长焦、全局语音摘要功能等。
OPPO	Find X9	2025.10	天玑 9500	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	小布 AI 智能助手支持一键闪记、主动智能建议、系统级 AI 集成等；影像 AI 功能支持 AI 人像补光、AI 灵感成片、Live 图 AI 消除等。
OPPO	Find X10/Pro Max	2026.9	天玑 9600 Pro	16GB LPDDR5X，最高 1TB 存储空间	-	-	小布新一代智能：核心升级点，具备记忆、场景感知、工具调用，支持跨 App 自动完成链式任务等。
vivo	X200	2024.10	天玑 9400	16GB LPDDR5X、最高 1TB 存储空间	vivo 蓝心大模型	1B/7B	支持超能问答、超能创作、超能搜索、超能管理、超能交互、原子岛、小 V 电话助手、小 V 写作等。
vivo	X300	2025.10	天玑 9500	16GB LPDDR5X、最高 1TB 存储空间	-	-	影像 AI 功能包括 AI 电影分镜、灵动人像算法、AI 定制美颜、Live Photo 路人消除等，系统 AI 功能包括小 V 圈搜 2.0 等。
vivo	X500	2026.9	天玑 9600 Pro	16GB LPDDR5X、最高 1TB 存储空间	-	-	蓝心小 V 智能体支持全套影像 AI、文档摘要、圈选搜索、会议 AI 等，具备记忆、工具调用、任务规划、跨应用自动执行多步骤任务等。

资料来源：各公司官网，中原证券研究所

Canalys 预计 2026 年 AI 手机渗透率将达到 45%，端侧模型的精简以及芯片算力的升级将进一步助推 AI 手机向中端价位段渗透。2025 年芯片厂商发布的新款次旗舰 SoC，如 Snapdragon 8s Gen4, Dimensity 9400e 已经具备了流畅运行端侧大模型的能力，Deepseek 的出现也在很大程度上降低了大模型对于芯片算力的开销，在这两大因素的共同作用下，2025-2026 年 AI 手机仍预计会保持高速渗透的趋势。根据 Canalys 的预测， 2024 年全球智能手机出货量中 18%为 AI 手机，预计 2025 年渗透率将快速提升至 34%，预计 2026 年将达到 45%。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

图 14：2024-2029 年全球 AI 手机出货量及预测情况

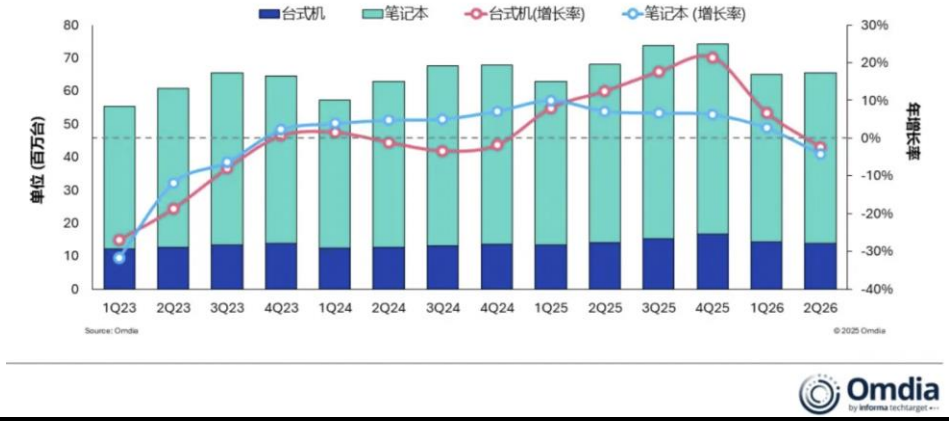


资料来源：Canalys，中原证券研究所

2.2.2. 全球 PC 季度出货量继续同比下降，预计 2026 年全球 PC 出货量大幅下降

全球 PC 出货量 26Q2 同比下降 3.6%。根据 Omdia 的数据，2026 年第二季度全球台式电脑、笔记本电脑及工作站出货量同比下降 3.6%，降至 6570 万台；其中，台式电脑（含台式工作站）出货量为 1390 万台，同比下降 1.3%；笔记本电脑（含移动工作站）出货量为 5170 万台，同比下降 4.2%。Omdia 预计 2026 年下半年存储器和存储产品的成本涨幅将明显放缓，但 PC 整机售价仍将受到 2026 年第二季度上游零部件成本上涨的持续影响。Omdia 研究显示，今年内存储器和存储产品价格均无明显回落的迹象，同时 MLCC、PCB 等其他关键零部件价格也在持续上涨。因此，PC 厂商预计仍将把不断增加的成本压力转嫁给终端市场，这将进一步抑制 2026 年下半年的市场需求。

图 15：23Q1-26Q2 年全球 PC 季度出货量情况



资料来源：Omdia，中原证券研究所

26Q2 全球 PC 市场厂商前五名分别为联想、惠普、戴尔、苹果和华硕。根据 Omdia 的数据，2026 年第二季度，联想继续稳居全球 PC 市场第一，出货量达到 1662 万台，同比下降 2%，仍保持 25%的市场份额；惠普以 1300 万台的出货量位居第二，但受市场环境影响，出货量同比下降 9%；戴尔排名第三，在供应持续紧张的市场环境下展现出较强韧性，出货量达到 929 万台，市场份额维持在 14%；苹果成为前五大厂商中增长最快的品牌，受 MacBook Neo 上市以及市场需求持续向好的带动，第二季度出货量达到 725 万台，市场份额较 2025 年第二季度提升 2%；华硕位列第五，出货量为 501 万台，整体表现与去年同期基本持平。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

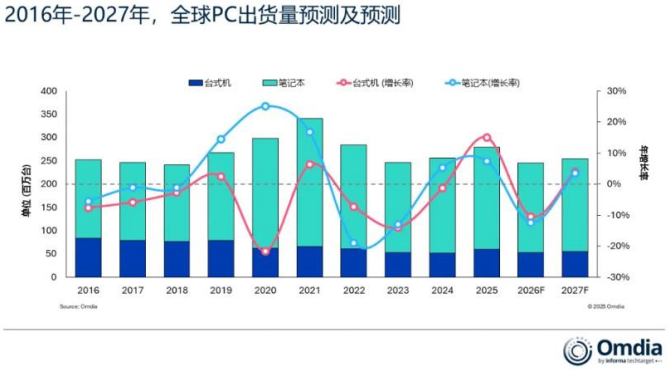
表 8：26Q2 全球 PC 厂商市场份额情况

公司	26Q2 出货量（百万台）	26Q2 市场份额（%）	25Q2 出货量（百万台）	25Q2 市场份额（%）	26Q2 同比增速（%）
联想	16.6	25.3	17.0	24.9	-2.1
惠普	13.0	19.8	14.3	21.0	-9.0
戴尔	9.3	14.1	9.8	14.3	-4.9
苹果	7.3	11.1	6.3	9.2	15.9
华硕	5.0	7.6	5.0	7.3	0.9
其他	14.5	22.0	15.8	23.2	-8.5
合计	65.7	100	68.1	100	-3.6

资料来源：Omdia，中原证券研究所

Omdia 预计 2026 年全球 PC 出货量下降 12%。根据 Omdia 的预测，2026 年全球台式机、笔记本及工作站出货量预计下降 12%，至 2.45 亿台；这一预测基于内存与存储价格的急剧上涨——特别是预计 2026 年第一季度将至少上涨 60%；预计全年剩余季度仍将面临进一步的价格上涨压力，但后续涨幅可能更加温和；自 2025 年第一季度以来，主流内存与存储配置的成本已上涨 90 至 165 美元，对 PC 厂商造成重大财务压力，迫使其减少促销、提高产品售价并调整配置；各类 PC 产品受影响的程度预计大体一致，台式机出货量预计下降 10%至 5320 万台，笔记本出货量预计下降 12%至 1.922 亿台。

图 16：2016-2027 年全球 PC 出货量及预测情况



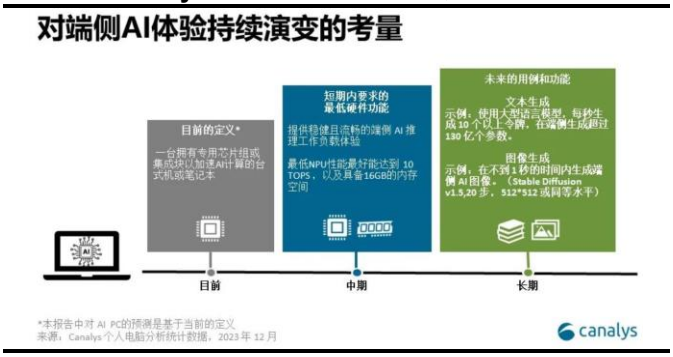
资料来源：Omdia，中原证券研究所

AI PC 是端侧 AI 落地的重要应用场景，将推动 PC 产业生态加速迭代。具备 AI 功能的个人电脑（AI PC）的问世有望重振市场并改变用户体验，将专用的 AI 加速硬件集成到 PC 中，可以在效率、生产力、协作和创造力方面实现惊人的创新。Canalys 提出 AI PC 需要具备专用芯片组/块以承载端侧的 AI 运行负载。微软和英特尔联合提出 AI PC 的定义，即 AI PC 需要配备 NPU、CPU 和 GPU，并支持微软的 Copilot，且键盘上直接配有 Copilot 物理按键（该键取代了键盘右侧第二个 Windows 键）。AI PC 是终端、边缘计算和云技术的颠覆性混合体，它不仅重新定义生产力，也将推动 PC 产业生态加速迭代。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

图 17：Canalys 对 AI PC 的定义及未来演变的考量



资料来源：Canalys，中原证券研究所

图 18：微软和英特尔对 AI PC 的定义



资料来源：微软，英特尔，IT 之家，中原证券研究所

英特尔、AMD 等芯片厂商持续迭代适用于 AI PC 的处理器芯片，NPU 算力不断提升。2024 年 9 月 4 日，英特尔发布超高能效的 x86 处理器家族——英特尔酷睿 Ultra 200V 系列处理器，CPU、NPU 和 GPU 的整体平台算力高达 120 TOPS，在实现跨模型和引擎的同时提供极具兼容和性能的 AI 体验，整体功耗降低了 50%，使搭载该处理器为 AI PC 带来超前的低功耗表现。2024 年 6 月 4 日，AMD 为下一代 AI PC 推出锐龙 AI 300 系列处理器，采用全新的“Zen 5”架构，配备高达 12 颗高性能 CPU 核心和 24 个线程；采用基于全新 AMD XDNA 2 架构的专用 AI 引擎，NPU 拥有 50 TOPS 的 AI 处理能力；采用全新的 AMD RDNA 3.5 图形架构，配备最新的 AMD Radeon 800M 系列显卡，带来流畅的帧速率和 3A 游戏体验。英特尔、AMD、高通和苹果等芯片厂商持续迭代适用于 AI PC 的处理器芯片，联想、惠普等 PC 厂商陆续发布 AI PC 新品。

表 9：全球主要处理器厂商发布的适用于 AI PC 处理器情况

厂商	处理器	发布时间	CPU	GPU	NPU AI 算力	存储器	制程
英特尔	酷睿 Ultra 9	2023.12	16 核心（6+8+2）/22 线程，最高主频 5.1GHz	Intel Arc GPU，8 个 Xe 核显	34TOPS	支持最多 64GB 的 LPDDR5/5X-7467 和 96GB DDR5-5600	Intel 4
英特尔	酷睿 Ultra 200V	2024.9	8 核 8 线程，最高主频 5.1GHz	Intel Arc 100V GPU	NPU 算力最高 48TOPS，整体算力 120TOPS	支持最大 32GB 的 LPDDR5X-8533	3nm
AMD	锐龙 8040	2023.12	Zen 4 架构，8 核心/16 线程，最高主频 5.2GHz	RDNA 3 架构，12 个计算单元	NPU 算力 16TOPS，整体算力 39TOPS	-	4nm
AMD	锐龙 AI 300	2024.6	Zen 5 架构，12 核心/24 线程，最高主频 5.1GHz	RDNA 3.5 架构，16 个计算单元	50 TOPS	-	4nm
高通	骁龙 X Elite	2023.10	Oryon CPU，12 核，最高主频 3.8GHz	Adreno GPU，算力达 4.6TFlops	NPU 算力 45TOPS，整体算力 75TOPS	支持 LPDDR5X 8533MHz，最大容量 64GB	4nm
苹果	M3	2023.10	8 个 CPU 核心	10 个 GPU 核心	18TOPS	支持内存容量最高达 128GB	3nm
苹果	M4	2024.5	10 个 CPU 核心	10 个 GPU 核心	38TOPS	支持内存容量最高达 128GB	3nm

资料来源：各公司官网，中关村在线，IT 之家，中原证券研究所

联想、惠普等 PC 厂商陆续发布 AI PC 新品。AI PC 是终端、边缘计算和云技术的颠覆性

下载日志已记录，仅供内部参考

混合体，它不仅重新定义生产力，也将推动 PC 产业生态加速迭代。头部 PC 厂商视 AI PC 为重要的创新机会，PC 行业迎来 iPhone 时刻。随着英特尔、AMD 等芯片厂商陆续推出适用于 AI PC 的计算芯片，以及 Windows 向 Windows11 过渡，头部 PC 厂商联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁、华硕、三星、荣耀、华为等都陆续推出全新的 AI PC 产品。

表 10：全球部分 PC 厂商 AI PC 布局情况

厂商	型号	处理器	内存	硬盘	软件
联想	Thinkpad X1 Carbon AI	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5x 6400Mhz	2TB PCIe NVMe Gen4 高速固态硬盘	内置了全新的 AI 智能会议助手，可以通过 AI 完成会议邮件撰写、发送会议邀请，撰写会议纪要等工作，实现 AI 智能降噪等；实现一秒之内完成图片创作。
	小新 Pro AI 超能本 2024	英特尔酷睿 Ultra 9	32GB LPDDR5x 7467MT/s	1TB PCIe 4.0 高性能固态硬盘	通过智能语音助手、智能图像识别等技术，为用户提供更便捷、高效的使用体验；支持智能家居控制，可以通过语音指令实现对家中各种设备的远程控制。
惠普	星 Book Pro 14	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5X	1TB PCIe 4.0 固态硬盘	支持智能语音助手，支持实时翻译，更精准，可收录来自系统声音，支持中英文互译，可译文或原译文同时显示字幕。
	Spectre x360 商务本	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5x 7467Mhz	2TB PCIe 4.0 高性能固态硬盘	支持 AI 智能降噪功能，智能追焦取景，AI 智能字幕翻译，支持语音输入和会议笔记功能，能够实时记录语音并翻译，支持中英/英中互译。
戴尔	灵越 16Plus	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5X	1TB PCIe 4.0 固态硬盘	与 100 多个 AI APP 加速合作；AI 智能降噪、AI 眼神锁定和 AI 背景虚化等智能功能的全面覆盖。
	XPS 16	英特尔酷睿 Ultra 9	64GB LPDDR5X	2TB PCIe 4.0 固态硬盘	搭载 Windows 11 系统，支持 200 亿参数大模型运行，能够实现本地生图。
苹果	MacBook Air	M3	24GB 100GB/s	2TB 固态硬盘	实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等。
宏基	非凡 Go 14	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5X	1TB PCIe 4.0 高速固态硬盘	支持智能视频会议,自动取景、眼神接触、物理防窥、AI 降噪。
华硕	灵耀 14 2024	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5x	1TB PCIe 4.0 高速固态硬盘	支持 200 亿参数的大模型，即使不联网也能实现问答、文本创作、摘要生成、编程、翻译等多种功能。
三星	Galaxy Book 4 Ultra	英特尔酷睿 Ultra 9	64GB LPDDR5X	2TB PCIe 4.0 固态硬盘	与 100 多个软件供应商加速合作，支持 Galaxy AI 功能，支持智能搜索和翻译，利用 AI 技术对照片进行智能编辑。
荣耀	MagicBook Pro 16	英特尔酷睿 Ultra 7	32GB LPDDR5X	1TB PCIe 4.0 固态硬盘	配备 YOYO AI 超级助理凭借其先进的 AI 语义理解能力，实现了智慧搜索、文档总结以及智能推荐等多项功能。
华为	Matebook X Pro	英特尔酷睿 Ultra 9	32GB LPDDR5X	2TB PCIe 4.0 固态硬盘	内置华为盘古大模型，搭载 AI 空间功能，支持 100+个智能体，为用户提供从代码编写、文档处理到创意设计、信息检索等；能从音视频或实时纪要的海量信息中，快速精准地提炼关键点，生成摘要；支持 AI 字幕，实时翻译等功能。

资料来源：各公司官网，中原证券研究所

预计 AI PC 渗透率将持续快速提升。根据 Canalys 的数据，2024 年第四季度，AI PC 出货量达到 1540 万台，占季度 PC 总出货量的 23%；2024 年 AI PC 占 PC 总出货量的 17%；其中苹果以 54%的市场份额领跑，联想和惠普各占 12%。受 Windows 10 服务停止带来的换机潮，预计 AI PC 的市场渗透率将在 2025 年继续提升。展望未来，受商用需求的推动，PC 市场将加速增长，企业正为 Windows 10 系统结束做准备；目前 PC 市场正致力于将 AI PC 打造成明星类别，根据 Canalys 的预测，预计 2025 年 AI PC 将占全球 PC 出货量的 35%。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

图 19：23Q4-24Q4 全球 AI PC 出货量情况



资料来源：Canalys，中原证券研究所

图 20：24Q1-25Q4 全球 PC 及 AI PC 出货量及预测



资料来源：Canalys，中原证券研究所

AI PC 有望推动高端 PC 市场收入增长。AI PC 集成了专用于 AI 的加速器，将释放出高生产力、个性化及能效方面的新功能，颠覆整个 PC 市场，并为厂商及其合作伙伴带来显著的价值收益。根据 Canalys 的预测，与未集成 NPU 的传统 PC 相比，AI PC 将溢价 10%-15%；随着采用率的激增，到 2025 年底，价格在 800 美元及以上的 PC 将有一半以上是 AI PC，到 2028 年，这一比例将增至 80%以上。因此，800 美元及以上的 PC 出货量将在短短四年内增长到市场的一半以上，这将有助于推动 PC 出货的整体价值从 2024 年的 2250 亿美元增长到 2028 年的 2700 亿美元以上。

图 21：2024-2028 年全球 PC 市场总收入预测情况



资料来源：Canalys，中原证券研究所

2.2.3. AI 眼镜是端侧 AI 最佳硬件载体之一，2026 年全球 AI 眼镜出货量有望快速增长

AI 眼镜是端侧 AI 最佳硬件载体之一。嘴巴、耳朵和眼睛是人体三大重要感官器官，嘴巴是语言输出器官，耳朵是语音接受的器官，眼睛则是人类最重要的信息摄入器官，人 80%的信息来源于视觉。眼镜是最靠近人体三大重要感官的穿戴设备，是端侧 AI 最佳硬件载体之一，可以非常直接和自然的实现声音、语言、视觉的输入和输出。

下载日志已记录，仅供内部参考

图 22：Ray-Ban Meta 产品示意图



资料来源：腾讯，中原证券研究所

图 23：Ray-Ban Meta 产品支持耳机功能



资料来源：腾讯，中原证券研究所

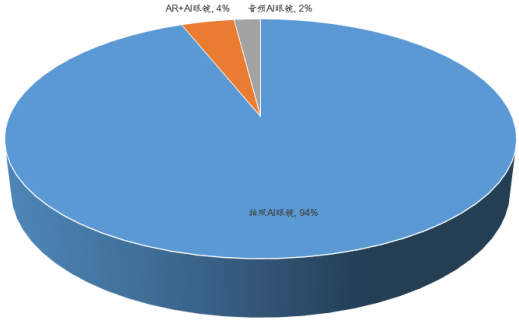
AI 眼镜是在普通眼镜的基础上，增加 AI 功能，拍照 AI 眼镜为当前主流形态。AI 眼镜的产品形态包括音频 AI 眼镜、拍照 AI 眼镜、AR+AI 眼镜；传统蓝牙音频眼镜接入 AI 大模型，是 AI 眼镜的基础形态，AI 大模型通过语音交互方式提供基础的智能服务；拍照 AI 眼镜是在音频 AI 眼镜的基础上增加摄像头，AI 大模型可通过摄像头感知周边环境，提供与当下环境具备交互能力的智能服务；AR+AI 眼镜是具备 AR 显示功能、并且接入大模型的眼镜，部分眼镜具备拍照、空间定位等多模态感知能力，AI 大模型可通过 AR 显示实现实时信息输出，实现更简便的信息交互。根据 wellsenn XR 的数据，2024 年全球 AI 眼镜销量中 94%为拍照 AI 眼镜，4%为 AR+AI 眼镜，2%为音频 AI 眼镜。

图 24：AI 眼镜产品形态分类情况



资料来源：wellsenn XR，中原证券研究所

图 25：拍照 AI 眼镜为当前主流形态

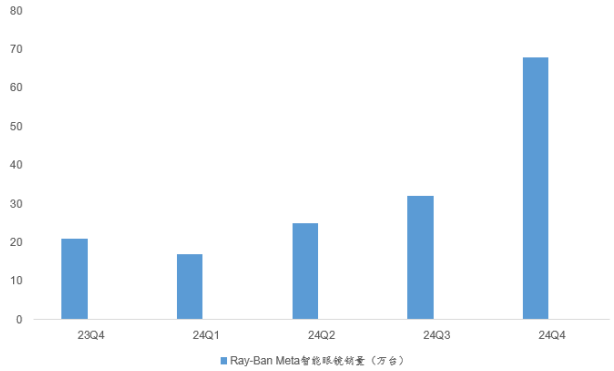


资料来源：wellsenn XR，中原证券研究所

Ray-Ban Meta 发布后热销，带动大量厂商加速进入 AI 眼镜市场。2023 年 9 月，Meta 联合雷朋推出 Ray-Ban Meta 智能眼镜，Ray-Ban Meta 为眼镜增加了摄像、耳机，以及 AI 功能。用户可以通过语音与 Meta AI 进行互动，获取各种信息和服务；支持英语、西班牙语、意大利语、法语和德语之间的互译，能够翻译所拍摄到的标识和文字，并以对应的语言念出来。根据 wellsenn XR 的数据，2024 年 Ray-Ban Meta 眼镜出货量达 142 万台。Ray-Ban Meta 智能眼镜发布后热销,带动百度、华为、小米、三星、雷鸟等厂商加速进入 AI 眼镜市场。

下载日志已记录，仅供内部参考

图 26：23Q4-24Q4 Ray-Ban Meta 眼镜出货量情况



资料来源：wellsenn XR，中原证券研究所

百度发布全球首款搭载中文大模型的原生 AI 眼镜。2024 年 11 月 12 日，百度正式发布小度 AI 眼镜，称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生 AI 眼镜”。小度 AI 眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。小度 AI 眼镜支持文心大模型，对接百度地图、搜索、百科等百度应用生态。

图 27：小度 AI 眼镜产品示意图



资料来源：百度，IT 之家，中原证券研究所

图 28：小度 AI 眼镜产品配置及功能情况



资料来源：百度，IT 之家，中原证券研究所

华为发布智能眼镜 2——钛空圆框光学镜。2025 年 4 月 16 日消息，华为正式发布智能眼镜 2——钛空圆框光学镜；华为智能眼镜 2 设计整体风格时尚，眼镜的“鸢尾”雕花设计精致高雅，钛金属镜框不仅轻巧坚固，还经过 33 道工序精雕细琢，确保了产品的耐用性和美观性；华为智能眼镜 2 配备小艺翻译、头部控制等功能，支持面对面翻译、同声传译、全天候智慧播报，续航为 11 小时，售价 2299 元。

图 29：华为智能眼镜 2 产品示意图



资料来源：华为官网，中原证券研究所

图 30：华为智能眼镜 2 产品示意图



原：华为官网，中原证券研究所

雷鸟发布 AI 拍摄智能眼镜及全彩光波导 AR 眼镜。2025 年 1 月 7 日，雷鸟 V3 AI 拍摄智

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

能眼镜正式发布，售价 1799 元起；雷鸟 V3 搭载第一代高通骁龙 AR1 平台，采用台积电 4nm 工艺；搭载与 TCL 联合调教的“猎鹰影像”，采用 5 层镀膜光学镜片，搭载索尼 IMX681 背照式 CMOS；雷鸟 AI 支持全景式智能搜索，覆盖海量知识领域；电池容量 159mAh，40 分钟可充满，可用 7 小时；重量为 39g（不含镜片），采用钛合金金属转轴、肤感鼻托，专为亚洲人脸型设计。2025 年 5 月 27 日，雷鸟 X3 Pro 旗舰 AR 眼镜正式发布；雷鸟 X3 Pro 为全彩光波导 AR 眼镜，采用新一代二维扩瞳衍射光波导镜片，搭载新一代萤火光引擎，采用三色合色全彩方案，内置 JBD 定制红绿蓝三原色屏幕，配合 0.1cc 超小聚合 Cube 棱镜，实现 1670 万色全彩显示输出，峰值入眼亮度 6000nits，平均入眼亮度 3500nits，光引擎大小 0.36cc；雷鸟 X3 Pro 推出安卓虚拟机功能，可将手机 App 搬到眼镜中使用；持语音翻译、同声传译、图像翻译等多种翻译模式，以及高德地图 AR 导航、AI 助手连续对话等功能。

图 31：雷鸟 V3 AI 眼镜产品示意图



资料来源：IT 之家，中原证券研究所

图 32：雷鸟 X3 Pro AR 眼镜产品示意图



资料来源：IT 之家，中原证券研究所

Meta 与欧克利联合发布新款 AI 眼镜 Oakley Meta HSTN。2025 年 6 月 21 日，Meta 与美国知名运动品牌欧克利（Oakley）联合发布了新款 AI 眼镜 Oakley Meta HSTN，其定位为“高性能 AI 眼镜（Performance AI Glass）”，主打运动场景。Oakley Meta HSTN 支持 POV 视频拍摄、Meta AI 助理，常规使用状态下续航时间可达 8 小时，待机续航时间长达 19 小时，并且支持快充；这款眼镜采用最先进的 Oakley PRIZM 镜片，结合 Oakley 的 PRIZM Lens 技术，旨在帮助运动员在不断变化的光线和天气条件下获得更清晰的视野；该产品将于 7 月 11 日开始预售，起售价 399 美元（约 2868 元人民币），限量版 499 美元（约 3587 元人民币）。

图 33：Oakley Meta HSTN AI 眼镜产品示意图



资料来源：IT 之家，中原证券研究所

图 34：Oakley Meta HSTN AI 眼镜产品示意图



资料来源：IT 之家，中原证券研究所

小米发布首款 AI 眼镜。2025 年 6 月 26 日，小米首款 AI 眼镜发布，小米 AI 眼镜是面向

下载日志已记录，仅供内部参考

下一代的个人智能设备，售价 1999 元起，电致变色版本 2699 元，彩色版本 2999 元。小米 AI 眼镜采用经典威灵顿式 D 型方框设计，12 度外翻转轴解决传统智能眼镜夹头痛点，40 克裸框重量搭配黑、玳瑁棕、鹦鹉绿三色半透明镜架，支持线下 400 家门店验光与线上定制处方镜片；1200 万像素 IMX681 传感器实现 0.8 秒疾速拍摄与 2K 视频录制；四麦克风阵列结合骨传导技术提升复杂环境收音效果；通过 HyperOS 系统，眼镜可替代手机摄像头用于微信、QQ 视频通话，还与 B 站、抖音等平台打通直播推流功能；内置小爱同学支持十语种同声传译、卡路里识别等 AI 应用，可呼唤小爱同学开启第一人称视角拍摄录像。

图 35：小米 AI 眼镜产品示意图



资料来源：小米官网，中原证券研究所

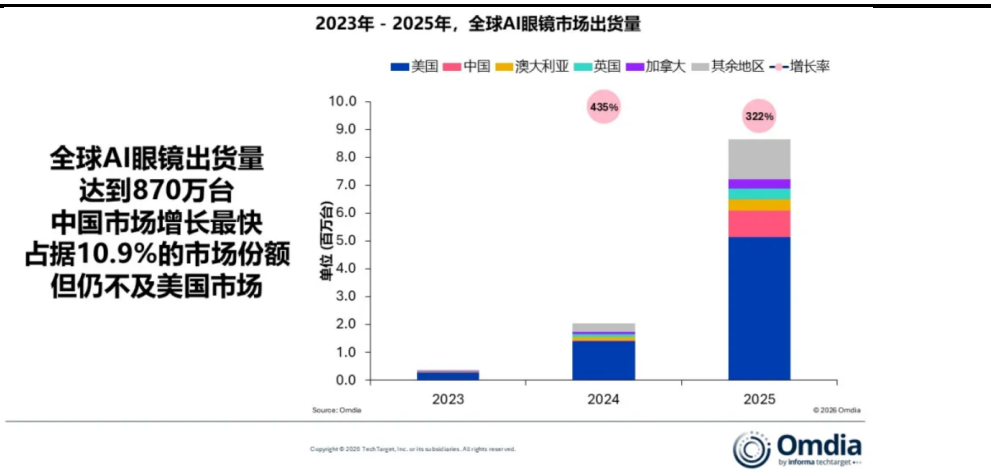
图 36：小米 AI 眼镜产品示意图



资料来源：小米官网，中原证券研究所

多款 AI 眼镜新品放量在即，有望推动全球 AI 眼镜出货量快速增长。根据 Omdia 的数据，2025 年全球 AI 眼镜出货量达到 870 万台，同比大幅增长 322%；预计 2026 年全球 AI 眼镜出货量将超过 1500 万台，这一增长将由多方面因素推动，包括主要设备厂商和科技巨头进入市场、Meta 提高产量并拓展新区域市场，以及印度、日本和韩国本土厂商的崛起。目前中国大陆市场占全球 AI 眼镜市场 10.9%的份额，出货量接近 100 万台，成为仅次于美国的全球第二大市场。

图 37：2023-2025 年全球 AI 眼镜出货量情况



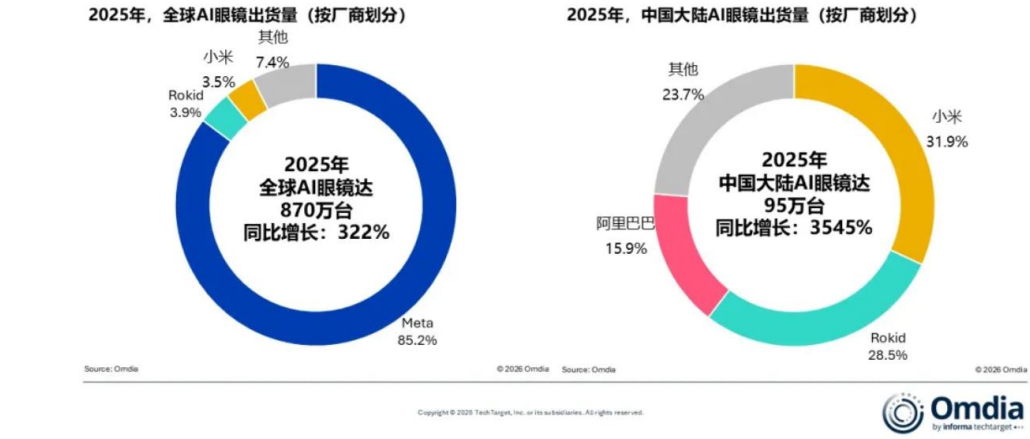
资料来源：Omdia，中原证券研究所

Meta 在全球 AI 眼镜市场占据绝对领先地位，国内厂商快速崛起。根据 Omdia 的数据，2025 年 Meta 的 AI 眼镜出货量达到 740 万台，同比增长 281.3%，市场份额达 85.2%，这一增长主要得益于 Oakley 和第二代 Ray-Ban 品牌 AI 眼镜的强劲表现，同时 Meta 也在积极拓

下载日志已记录，仅供内部参考

展新市场，包括印度、墨西哥、巴西等国家；中国厂商 Rokid 以及智能手机厂商小米快速崛起，分别位列第二和第三位。

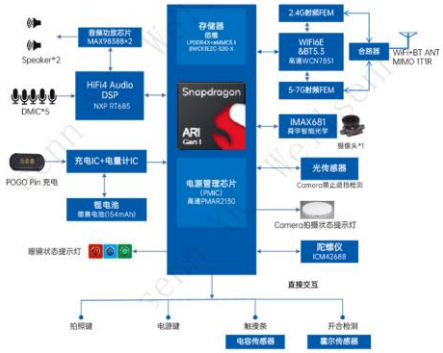
图 38：2025 年全球及中国大陆 AI 眼镜市场竞争格局情况



资料来源：Omdia，中原证券研究所

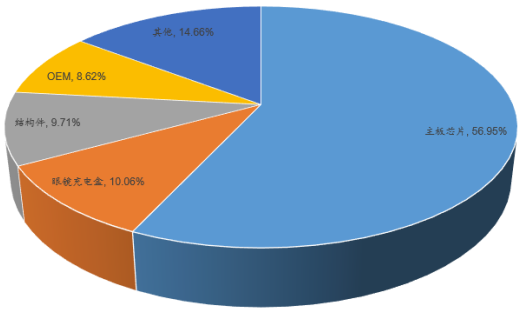
芯片占 AI 眼镜成本大部分，关注 AI 眼镜产业链核心环节投资机会。根据 wellsenn XR 的数据，RayBan Meta AI 眼镜成本总计 174 美元，主板芯片的成本约 99.1 美元，占比约 56.95%，成本占比超一半；眼镜充电盒的成本约 17.5 美元，占比约 10.06%；结构件的成本约 16.9 美元，占比约 9.71%；OEM 的成本约 15 美元，占比约 8.62%。AI 眼镜主要芯片包括 SoC、MCU、存储器、电源、射频等，建议关注 SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM 等产业链核心环节投资机会。

图 39：RayBan Meta AI 眼镜系统架构框图



资料来源：wellsenn XR，中原证券研究所

图 40：RayBan Meta AI 眼镜成本结构图



资料来源：wellsenn XR，中原证券研究所

2.2.4. 国内外云厂商持续加大资本支出，推动 AI 算力硬件基础设施需求旺盛

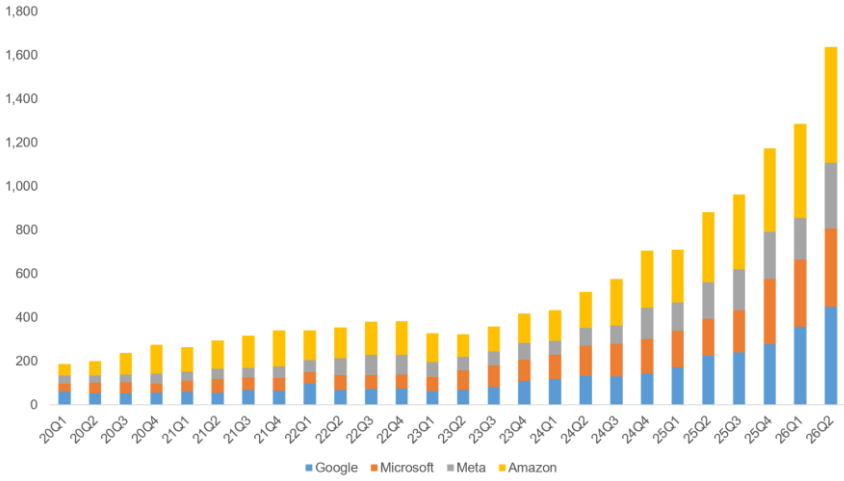
北美四大云厂商受益于 AI 对核心业务的推动，持续加大资本支出。受益于 AI 对于公司核心业务的推动，北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊 2023 年开始持续加大资本支出，2026 年第二季度四大云厂商的资本开支合计约为 1639 亿美元，同比增长 86%，环比增长 27%，推动 AI 算力硬件基础设施需求旺盛。

北美四大云厂商继续上调 2026 年资本支出计划。目前北美四大云厂商的资本支出增长主要用于 AI 基础设施的投资，并从 AI 投资中获得了积极回报，谷歌预计 2026 年资本支出将增加至 1950-2050 亿美元（原值为 1800-1900 亿美元），并预计 2027 年资本支出将进一步上

下载日志已记录，仅供内部参考

升；Meta 预计 2026 年资本支出为 1300-1450 亿美金（原值为 1250-1450 亿美元）；微软受数据中心使用寿命会计政策变更影响，预计 2026 年资本支出约为 1750 亿美元；亚马逊预计 2026 年资本支出约为 2200 亿美元（原值为 2000 亿美元），持续加大 AI 基础设施的投资力度。

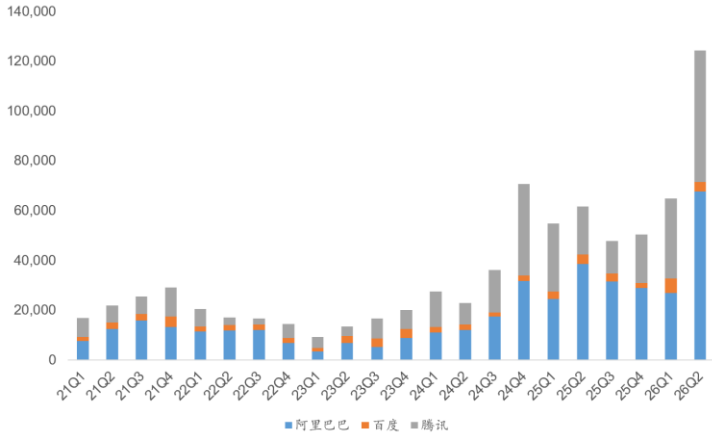
图 41：2020-2026 年北美四大云厂商资本开支情况（亿美元）



资料来源：各公司公告，Wind，中原证券研究所

国内三大互联网厂商不断提升资本开支。国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯 2023 年也开始不断加大资本开支，2026 年二季度三大互联网厂商的资本开支合计约为 1243 亿元，同比增长 102%，环比增长 92%；预计 2026 年国内三大互联网厂商将继续加大用于 AI 基础设施建设的资本开支。

图 42：2021-2026 年国内三大互联网厂商资本开支情况（百万元）



资料来源：各公司公告，中原证券研究所

2.2.5. 中国新能源汽车月度销量同比稳健增长

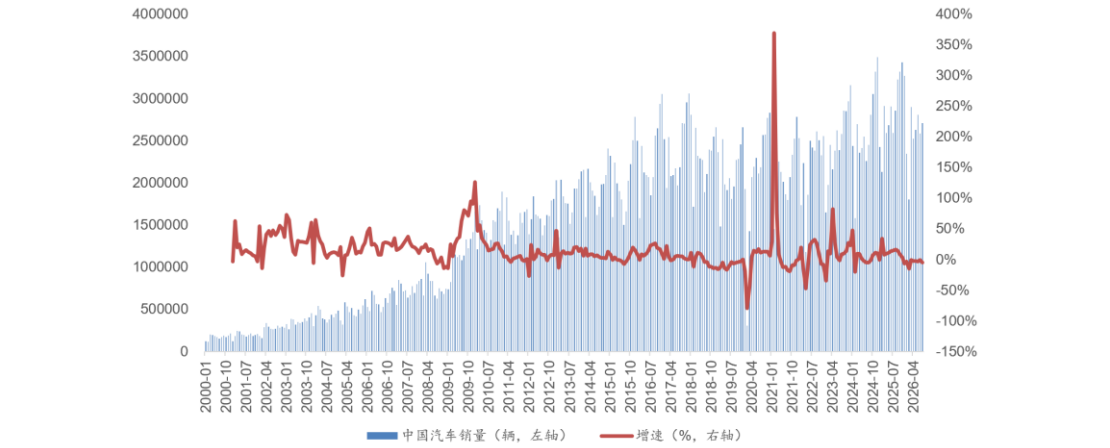
2026 年 8 月中国汽车销量同比下降 5.1%。根据中国汽车工业协会的统计数据，2026 年 8 月，中国汽车销量达到 271.2 万辆，同比下降 5.1%，环比增长 4.9%。8 月多地汽车消费补贴持续升级，车企促销活动活跃，国内市场继续承压，出口保持高速增长，成为稳定行业大盘的关键增量。近期，有关政府部门在规范账款支付、质量提升、车企出海行为等方面积极开展行动，汽车行业治理工作持续深化，将推动行业从追求规模和速度转向质量和安全，助力产业

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

健康可持续发展。

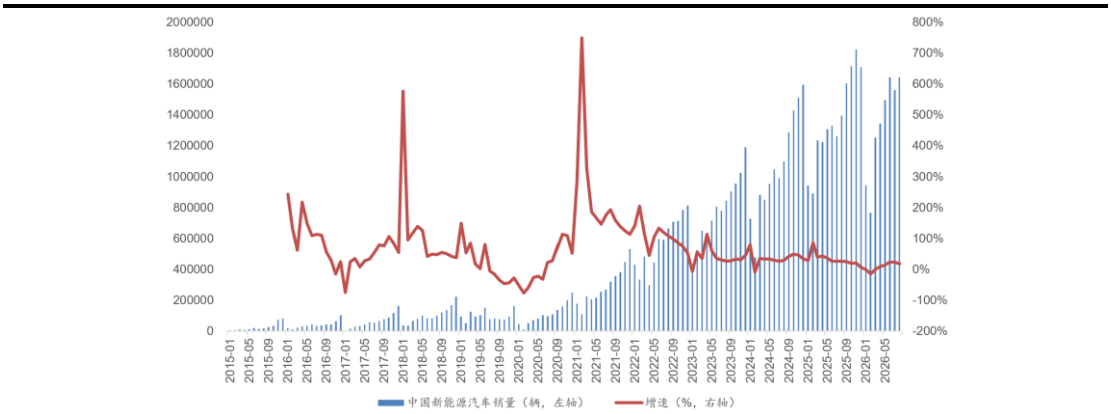
图 43：2000-2026 年中国汽车销量情况



资料来源：中国汽车工业协会，Wind，中原证券研究所

2026 年 8 月中国新能源汽车销量同比增长 17.8%。根据中国汽车工业协会统计数据，2026 年 8 月，中国新能源汽车销量 164.3 万辆，同比增长 17.8%，环比增长 5.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 60.6%。

图 44：2015-2026 年中国新能源汽车销量情况



资料来源：中国汽车工业协会，Wind，中原证券研究所

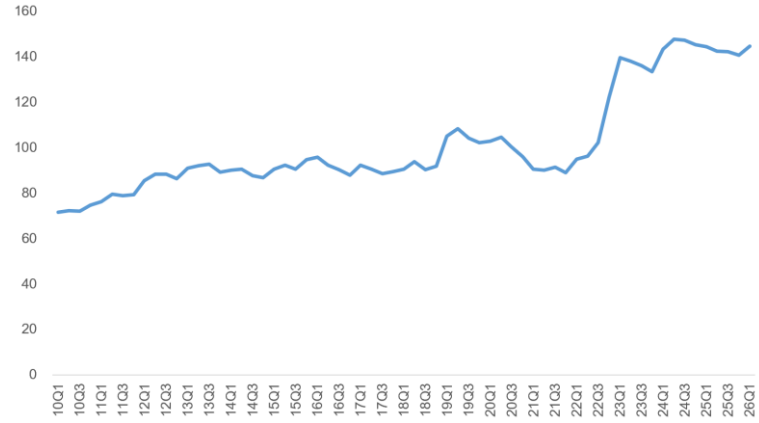
2.3. 全球部分芯片厂商季度库存水位环比下降，国内部分芯片厂商季度库存水位环比大幅下降

全球部分芯片厂商 26Q2 库存水位环比下降。根据 Wind 的数据，全球部分芯片厂商包括英特尔、AMD、英伟达、高通、博通、美光、TI、ADI、恩智浦、微芯、安森美 23Q1 的平均库存周转天数为 139 天，23Q4 下降至 133 天，随后开始环比提升，24Q2 提升至 148 天，随后开始逐步下降，25Q4 小幅下降至 141 天，26Q1 小幅提升至 145 天，26Q2 下降至 139 天；由于工业市场需求开始复苏，AI 数据中心需求旺盛，模拟厂商 TI、ADI、微芯科技等库存有望逐步下降。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

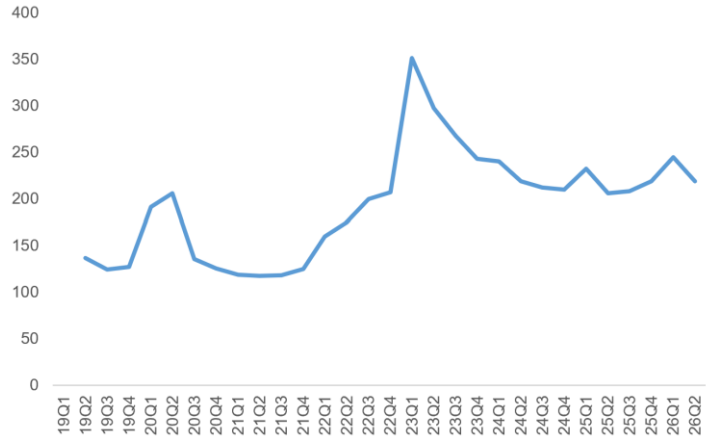
图 45：全球部分芯片厂商平均库存周转天数情况



资料来源：Wind，中原证券研究所（注：包括英特尔、AMD、英伟达、高通、博通、美光、TI、ADI、恩智浦、微芯、安森美）

国内部分芯片厂商 26Q2 库存水位环比大幅下降。国内部分芯片厂商包括兆易创新、卓胜微、韦尔股份、澜起科技、晶晨股份、瑞芯微、北京君正、圣邦股份、紫光国微 23Q1 的平均库存周转天数达到 351 天，随后逐步下降，24Q4 继续下降到 210 天，25Q1 提升至 232 天，25Q2 大幅下降至 206 天，随后逐步提升，26Q1 提升至 245 天，26Q2 大幅下降至 219 天，环比下降 26 天。26Q2 国内部分芯片厂商库存水位环比大幅下降，目前部分芯片设计厂商库存仍偏高，预计后续有望逐步回到健康水平。

图 46：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况



资料来源：Wind，中原证券研究所（注：包括兆易创新、卓胜微、韦尔股份、澜起科技、晶晨股份、瑞芯微、北京君正、圣邦股份、紫光国微）

2.4. 国内主要晶圆厂季度产能利用率环比小幅提升

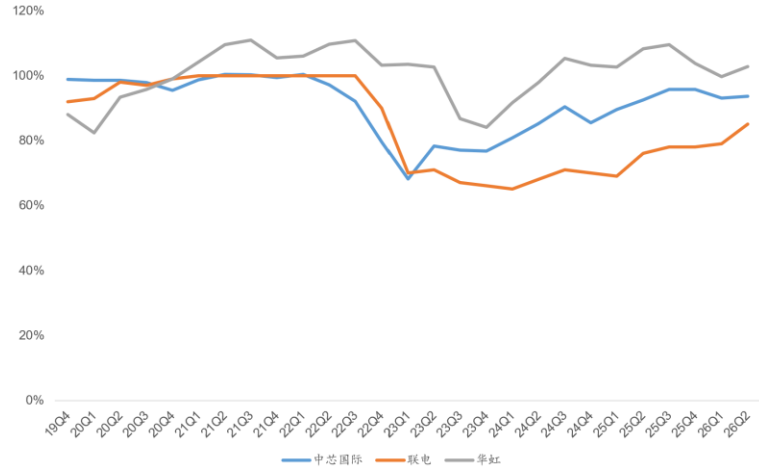
国内主要晶圆厂产能利用率 26Q2 环比小幅提升。半导体市场需求自 2022 年三季度大幅下跌，导致芯片原厂流片意愿不强，晶圆厂的产能利用率也出现下滑；国内晶圆代工龙头中芯国际 23Q1 的产能利用率从 22Q4 的 79.5%大幅下降至 68.1%，随后开始逐步回升，23Q2 至 23Q4 产能利用率在 76%-78%区间波动，24Q1 至 24Q4 产能利用率在 80%-90%区间波动，25Q1 至 25Q4 产能利用率从 89.60%提升至 95.7%，26Q1 产能利用率为 93.1%，26Q2 提升至 93.70%。华虹 23Q2 产能利用率从 23Q1 的 103.5%略微下降至 102.7%，随后开始大幅下降，23Q4 下滑至 84.1%，随后逐步提升至 24Q3 的 105.3%，24Q4 至 25Q1 小幅回落至

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

102.70%，25Q2 至 25Q3 继续提升至 109.5%，25Q4 至 26Q1 逐步回落至 99.7%，26Q2 提升至 102.80%；26Q2 中芯国际、华虹产能利用率环比小幅提升，处于满负荷运行状态。

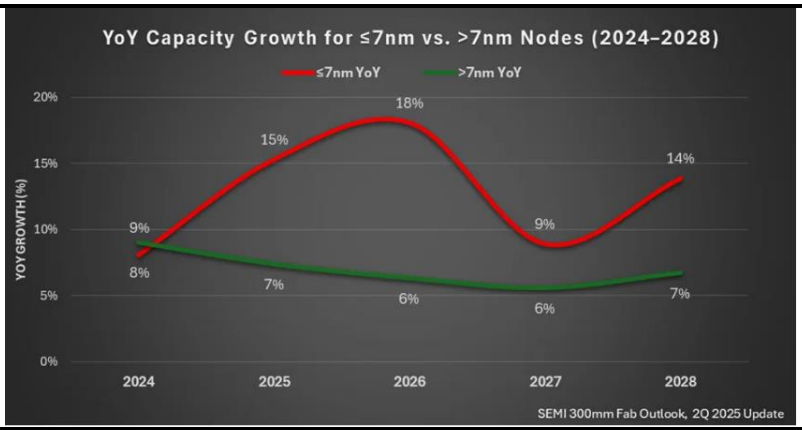
图 47：全球部分晶圆厂产能利用率情况



资料来源：各公司公告，中原证券研究所

AI 推动全球先进制造产能加速扩张。根据 SEMI 发布最新的《300 毫米晶圆厂展望报告（300mm Fab Outlook）》，全球半导体制造行业预计将保持强劲增长势头，预计从 2024 年底到 2028 年，产能将以 7%的复合年增长率增长，达到创纪录的每月 1110 万片晶圆；推动这一增长的关键因素是先进工艺产能（7 纳米及以下）的持续扩张，预计将从 2024 年的每月 85 万片晶圆增长到 2028 年的历史新高 140 万片晶圆，增长约 69%，复合年增长率约为 14%，是行业平均水平的两倍；AI 继续成为全球半导体行业的变革力量，推动全球先进制造产能加速扩张。

图 48：2024-2028 年全球晶圆产能及预测情况



资料来源：SEMI，中原证券研究所

TrendForce 预计晶圆代工成熟制程涨价效应有望延伸至 2027 年。根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，随着 AI 服务器、通用服务器与边缘 AI 周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明显朝 AI 相关产品倾斜，加速改变成熟制程供需结构；8 英寸制程受益于 AI 相关电源订单增量及台积电、三星电子减产，产能利用率与代工价格强势拉升；12 英寸成熟制程则因台积电启动减产，有望带动中长期转单效应；加上 55nm（含）以上 Power IC 订单强劲，引发台系晶圆厂减产 High Voltage（HV）制程、订单流向大陆系厂供应链等效应，以及 AI 相关新兴

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

应用增量排挤、原物料通膨等因素，导致 12 英寸成熟制程代工涨价氛围，预计涨势将延伸至 2027 年。

图 49：25H2-26H2 晶圆代工价格涨幅变化情况

2H25-2H26晶圆代工价格涨幅变化

Process Node	2H25	1H26	2H26
8-inch Processes	5-10% (specific processes only)	5-15%	0-10%
12-inch Mature Nodes	Flat	Flat	0-10%
12-inch Advanced Nodes	Flat	5-10%	Flat

Source: TrendForce, June 2026

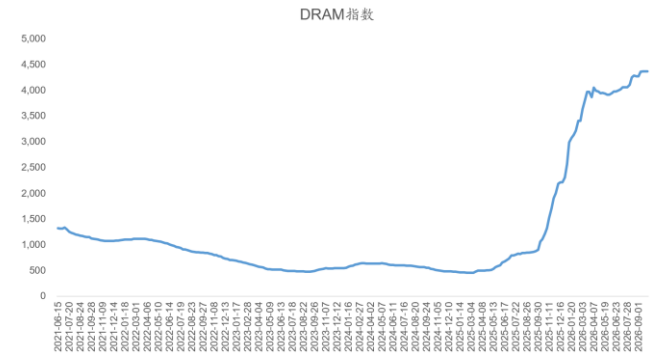
TrendForce

资料来源：TrendForce，中原证券研究所

2.5. DRAM 月度现货价格环比有所分化，NAND Flash 现货价格环比小幅下降

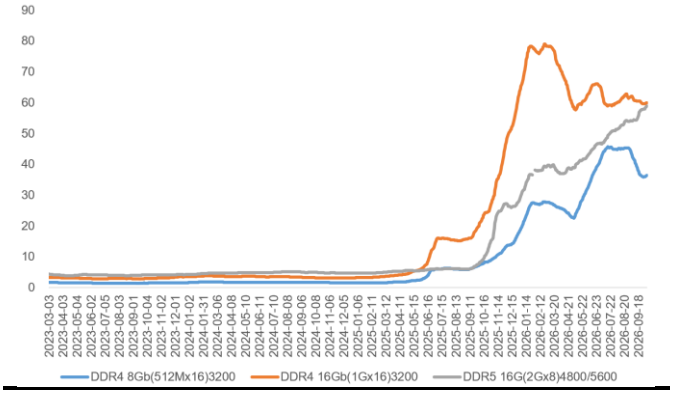
2026 年 9 月 DRAM 现货价格环比有所分化。根据中国闪存市场的数据，2026 年 9 月 DRAM 指数环比上涨约 2.19%，2025 年 3 月至 2026 年 9 月 DRAM 指数上涨约 865%。根据 DRAMexchange 的数据，2026 年 9 月，DDR4 8Gb(512Mx16)3200 的现货价格环比下跌 20.27%，DDR4 16Gb(1Gx16)3200 的现货价格环比下跌 3.24%，DDR5 16G(2Gx8)4800/5600 的现货价格环比上涨 7.38%。

图 50：DRAM 指数走势情况



资料来源：中国闪存市场，iFinD，中原证券研究所

图 51：DRAM 现货价格走势情况（美元）



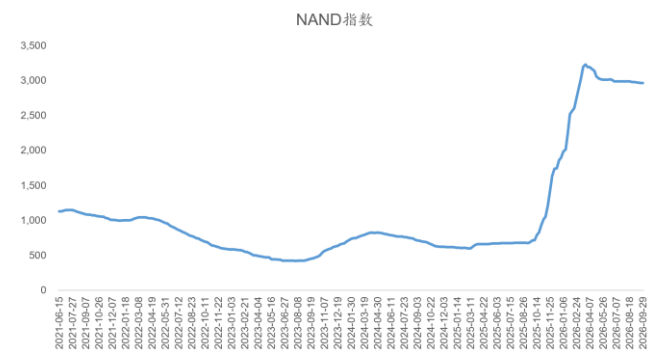
资料来源：DRAMexchange，iFinD，中原证券研究所

2026 年 9 月 NAND Flash 现货价格环比小幅下降。根据中国闪存市场的数据，2026 年 9 月 NAND 指数环比下降约 0.42%，2025 年 3 月至 2026 年 9 月 NAND 指数上涨约 393%；其中 TLC 闪存 256Gb 的现货价格环比持平，512Gb 的现货价格环比下降 2.22%。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

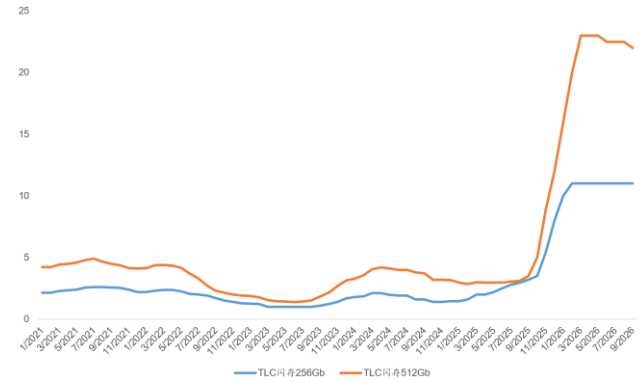
下载日志已记录，仅供内部参考

图 52：NAND 指数走势情况



资料来源：中国闪存市场，iFinD，中原证券研究所

图 53：NAND Flash 现货价格走势情况（美元）



资料来源：InSpectrum，中国闪存市场，中原证券研究所

TrendForce 预计 26Q4 DRAM 及 NAND Flash 合约价格分别环比增长 10%~15%及 15%~20%。根据 TrendForce 集邦咨询最新产业研究，2026 年第四季度，DRAM 原厂持续将先进制程投入生产服务器应用的高性能产品，整体维持供不应求格局，但是合约价涨势放缓，预计 Conventional DRAM（一般型 DRAM）将季增 10%~15%；NAND Flash 市场呈现 AI 加速与消费性需求低但仍连带涨价的双轨发展，预计整体合约价格将季增 15%~20%。

图 54：26Q3-26Q4 DRAM 及 NAND Flash 产品合约价格预测情况

3Q26-4Q26 DRAM、NAND Flash合约价格预测

	3Q26E	4Q26F
Total DRAM	Conventional DRAM: up 13~18% HBM Blended: up 8~13%	Conventional DRAM: up 10~15% HBM Blended: up 15~20%
Total NAND Flash	up 18~23%	up 15~20%

Source: TrendForce, Sept. 2026

TrendForce

资料来源：TrendForce，中原证券研究所

TrendForce 预计 262H NOR Flash 价格走势分化，高容量产品涨幅预计达 90-110%。根据 TrendForce 集邦咨询的调查，尽管新增供给有限，NOR Flash 需求持续成长；除了传统的 ADAS、数字座舱及工控应用，2026 年新增需求主力为 AI 与航天通信领域；以 AI Server 为例，单台对 NOR 的需求量为传统 Server 的三至五倍，且 AI Server 内部配备大量 Retimer 芯片，每颗 Retimer 均需要独立 NOR Flash 加载韧体，推升高容量及 Octal SPI NOR 需求；此外，Edge-AI、AI PC 与机器人等本地推理设备带动模型固件规模数倍膨胀，也提升高密度 NOR Flash 需求。TrendForce 指出，2026 年上半年 NOR Flash 合约价平均累计涨幅达 100-120%，预估 26H2 不同容量产品价格走势将分化，256Mb 及以上高容量产品有 AI Server、车用等强劲需求，加上供给主力厂商的新增位元有限，预估下半年平均价格仍有 90-110%的上涨空间；在 128Mb 及以下的中低容量市场，随着部分供应商产能逐步释出，消费类产品价格涨势趋缓，后续将进入高位盘整，预估 2026 年第四季度涨幅落在 10-20%之间。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

图 55：26H2 各类 NOR Flash 产品供需、价格趋势情况

产品类别	2H26供给状况	核心需求驱动力	2H26价格趋势
高容量 (≥256Mb)	严重供不应求	AI Server, ADAS, Edge-AI	持续上涨, 涨幅90-110%
Octal/ xSPI高端规格NOR	供应偏紧	AI芯片、高速数据传播	持续上涨
车规/航太高可靠度NOR	供给紧张	车用智能化、低轨卫星	持续上涨
通用型/中低容量NOR (≤128Mb)	供需相对平衡	消费电子、小家电、TWS	高档震荡/盘整

Source: TrendForce, Sept. 2026

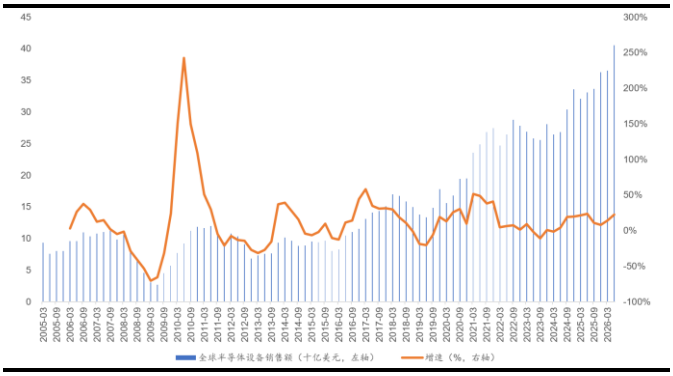
TrendForce

资料来源：TrendForce，中原证券研究所

2.6. 全球半导体设备季度销售额继续同比增长，预计 2026 年有望持续增长

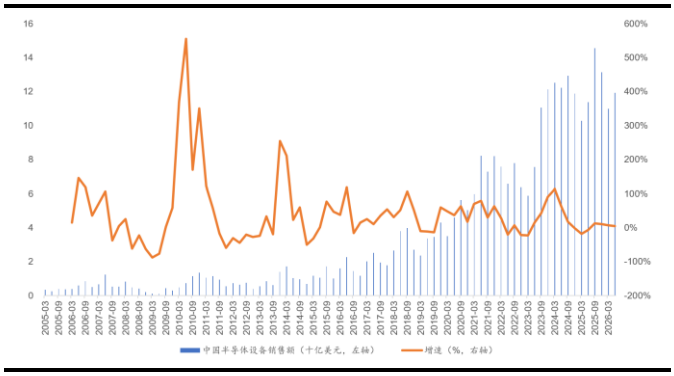
26Q2 全球半导体设备销售额同比增长 23%，中国半导体设备销售额同比增长 5%。根据日本半导体制造装置协会（SEAJ）的数据，2026 年第二季度全球半导体设备销售额为 405.3 亿美元，同比增长 23%，环比增长 11%；2026 年第二季度中国半导体设备销售额为 119.1 亿美元，同比增长 5%，环比增长 8%。

图 56：2005-2026 年全球半导体设备销售额情况



资料来源：SEAJ，iFinD，中原证券研究所

图 57：2005-2026 年中国半导体设备销售额情况



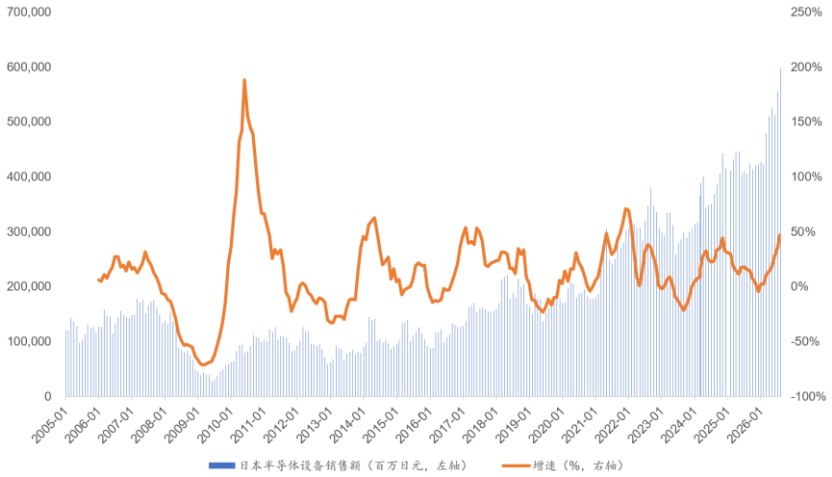
资料来源：SEAJ，iFinD，中原证券研究所

2026 年 8 月日本半导体设备销售额同比增长 47.4%。根据日本半导体制造装置协会的数据，2026 年 8 月日本半导体设备销售额为 5979.15 亿日元，同比增长 47.4%，环比增长 7.5%；2025 年日本半导体设备销售额达 5.0585 万亿日元，同比增长 14%；日本半导体设备全球市场占有率达三成，仅次于美国位居全球第 2。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

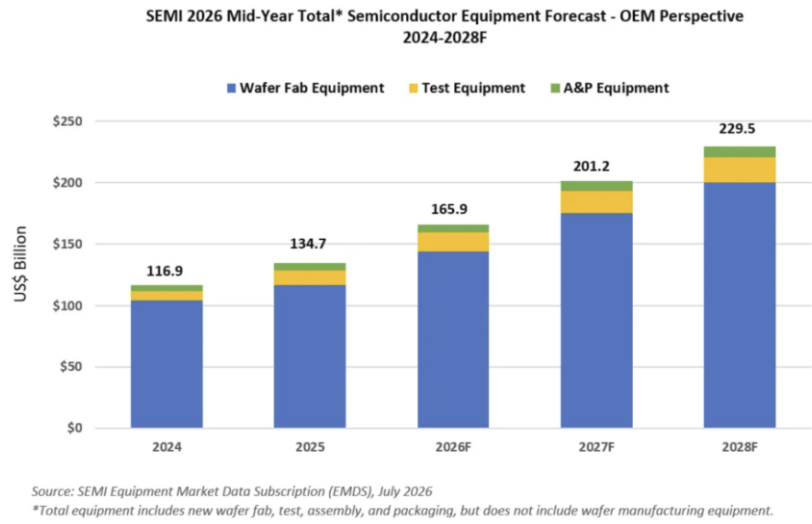
图 58：日本半导体设备月度销售额情况



资料来源：SEAJ，iFinD，中原证券研究所

SEMI 预计 2026 年半导体设备销售额将同比增长 23.2%。由于 AI 基础设施投资持续加速，以及支持更高计算密度、高带宽存储相关投资和日益复杂的器件架构所需的前沿逻辑、先进存储和后端技术投资的增加，推动全球半导体设备支出持续快速增长。根据 SEMI 的预测，预计 2026 年全球半导体设备销售额将创下 1659 亿美元的历史新高，同比增长 23.2%，增长势头预计将持续至 2028 年，预计 2028 年将达到 2295 亿美元，实现连续五年增长，AI 驱动的需求正在重塑半导体制造投资格局。由于晶圆厂正在加速产能扩张和技术迁移以满足 AI 相关工作负载需求，SEMI 预计 2026 年晶圆厂设备（WFE）领域销售额将增长 23.1%至 1439 亿美元，预计 2027 年再增长 21.8%，2028 年增长 14.1%，突破 2000 亿美元。受益于器件复杂度提升、先进异构封装采用率提高，以及 AI 和 HBM 器件对性能和可靠性更严格的要求，AI 相关半导体需求也在推动后端设备领域市场扩张，SEMI 预计 2026 年全球半导体测试设备销售额将增长 31%至 153 亿美元，预计 2026 年封装设备销售额将增长 9.6%至 67 亿美元，增长预计将持续至 2028 年，预计 2028 年测试设备及封装设备销售额将分别达到 208 亿美元和 86 亿美元。

图 59：2024-2028 年全球半导体设备销售额及预测按细分市场划分情况

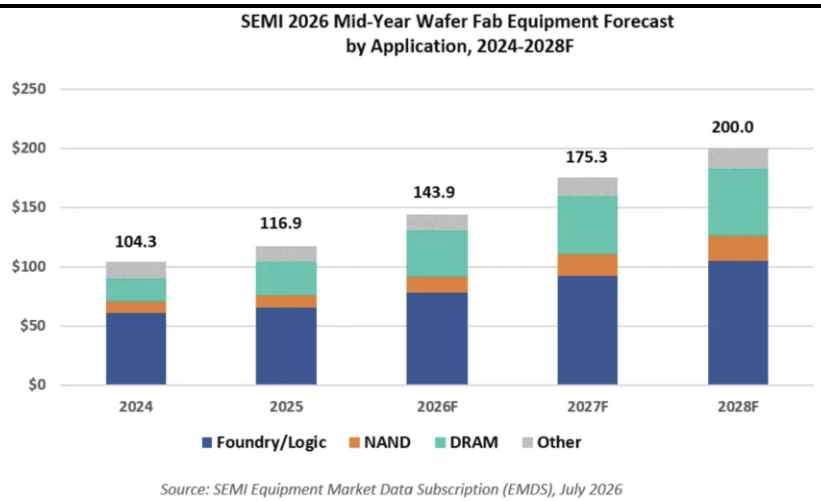


资料来源：SEMI，中原证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

存储相关设备支出有望持续加速扩张。受 AI 基础设施、数据中心及下一代计算系统投资增加的支撑，存储相关设备支出预计将在 2028 年前显著扩张，SEMI 预计 2026 年全球 DRAM 设备销售额同比增长 39.0%至 388 亿美元，预计 2027 年增长 27.4%，2028 年增长 15.0%，达到 569 亿美元；受益于 3D NAND 层数迁移和更高密度架构投资，SEMI 预计 2026 年全球 NAND 设备销售额同比增长 30.7%至 139 亿美元，2027 年再增长 31.1%，2028 年增长 14.5%，达到 208 亿美元。受益于 AI 加速器、高性能计算和高端移动处理器的前沿节点产能建设，SEMI 预计 2026 年用于逻辑应用的晶圆厂设备销售额同比增长 18.9%至 780 亿美元，预计 2027 年增长 18.1%，2028 年增长 13.6%，达到 1047 亿美元。

图 60：2024-2028 年全球晶圆厂设备销售额及预测按应用划分情况



资料来源：SEMI，中原证券研究所

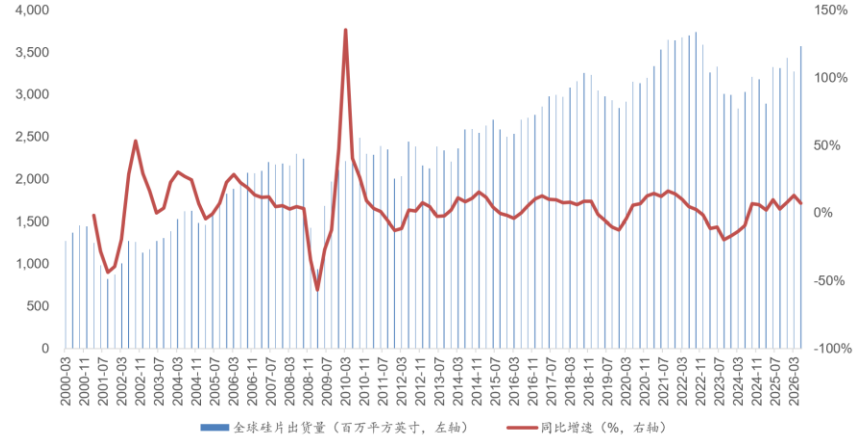
2.7. 全球硅片季度出货量继续同比增长，预计 2026 年将持续增长

26Q2 全球硅片出货量同比增长 7.4%。硅片是半导体产业链中最重要的材料之一，也是价值含量最高的半导体材料，占整个晶圆制造材料超过 33%。根据 SEMI 的数据，2026 年第二季度全球硅晶圆出货量达到 3573 百万平方英寸，同比增长 7.4%，环比增长 9.1%。SEMI SMG 主席、胜高株式会社（SUMCO）销售与市场事业部总经理矢田银次（Ginji Yada）表示：“第二季度硅晶圆出货量保持稳健增长，强劲且不断增长的 AI 相关需求已从先进逻辑和存储领域扩展至功率器件、光电子及其他市场；此外，工业和汽车需求正在复苏，而存储器价格压力则限制了 PC 和智能手机需求；器件制造商正大力投资扩产，硅晶圆需求增长预计将持续。”

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

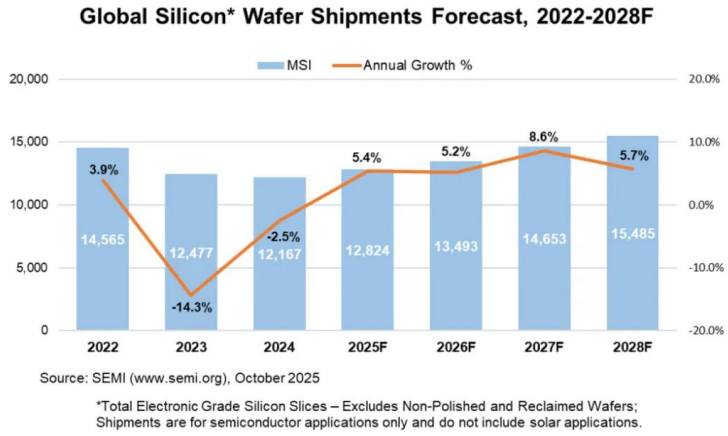
图 61：全球硅片出货量情况



资料来源：SEMI，Wind，中原证券研究所

SEMI 预计 2025-2028 年全球硅晶圆出货量将持续增长。根据 SEMI 的预测，预计 2026 年全球硅晶圆出货量预计将增长 5.2%，并将在 2028 年前持续增长，届时市场有望达到 15485 百万平方英寸的新行业纪录。2025 年硅晶圆出货量的增长主要受益于人工智能相关需求的强劲推动，包括用于先进逻辑器件的高端外延晶圆，以及用于高带宽存储器（HBM）的抛光晶圆；非 AI 应用领域的晶圆出货量则刚刚开始从近期的下行周期中逐步恢复；预计随着 AI 在数据中心及边缘计算领域的持续扩展，这一稳步增长趋势将延续至 2028 年。

图 62：2022-2027 年全球硅片出货量情况及预测



资料来源：SEMI，中原证券研究所

3. 行业政策

外部环境对中国半导体产业限制不断加剧。近年来美日荷不断加大对中国半导体产业的限制，主要针对半导体先进制造、先进制程半导体设备、先进存储器、先进计算芯片、EDA 工具等环节。

下载日志已记录，仅供内部参考

表 11：近年美日荷对中国半导体产业部分制裁政策情况

时间	具体事件及制裁政策情况
2018 年 10 月	美国商务部将福建省晋华集成电路有限公司列入出口管制“实体清单”。
2019 年 7 月	ASML 中止向中国交付 EUV 光刻机。
2020 年 5 月	美国商务部限制华为使用美国技术和软件在海外设计和制造半导体。
2020 年 9 月	美国商务部对华为实施严格的芯片禁令正式生效，台积电停止为华为代工生产麒麟芯片，高通、三星及 SK 海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。
2020 年 12 月	美国商务部将中芯国际列入出口管制“实体清单”。
2022 年 8 月	美国总统拜登签署《2022 芯片与科学法案》，该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供 527 亿美元，获得补贴的半导体企业将禁止在中国扩大或新增 14 纳米及以下先进制程芯片产业的投资。
2022 年 8 月	美国芯片厂商英伟达和 AMD 收到美国政府通知，要求停止向中国出口用于人工智能的高端计算芯片，该禁令影响的芯片分别为英伟达的 GPU A100 与 H100，以及 AMD 的 GPU MI200。
2022 年 10 月	美国商务部公布一系列针对中国的出口管制新规，BIS 这项新的半导体出口限制政策涉及到对中国的先进计算、半导体先进制造进行出口管制；具体要限制美国的半导体设备在国内应用到 16/14nm 及以下工艺节点（非平面架构）的逻辑电路制造、128 层及以上的 3D NAND 工艺制造、18nm 及以下的 DRAM 工艺制造；对中国超级计算机或半导体开发或生产最终用途的项目进行限制；限制美国公民支持中国半导体制造或者研发。
2022 年 12 月	美国商务部将长江存储、上海微电子、寒武纪等 36 家中国实体加入出口管制“实体清单”。
2023 年 5 月	日本政府正式发布针对先进芯片制造所需的 23 种半导体制造设备的出口管制措施，这些设备包括 3 项清洗设备、11 项薄膜沉积设备、1 项热处理设备、4 项光刻设备、3 项蚀刻设备、1 项测试设备。
2023 年 6 月	荷兰政府正式发布针对先进的芯片制造技术，包括先进的沉积设备和浸润式 DUV 光刻机实施出口管制。
2023 年 10 月	美国商务部公布针对先进计算芯片、半导体制造设备出口管制的更新规则，并将 13 家中国 GPU 企业列入实体清单，主要为壁仞科技和摩尔线程及其子公司。
2024 年 12 月	美国商务部修订了《出口管理条例》，这次制裁主要涉及半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并且扩展了对华出口管制的范围，包括了 24 种半导体制造设备、3 种软件工具和 HBM 芯片出口的限制，将 140 个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。新进入“实体清单”的企业包括北方华创、盛美上海、芯源微、拓荆科技、华峰测控、中科飞测、精测电子、华海清科、凯世通、至纯科技、武汉新芯、华大九天、沪硅产业、南大光电、闻泰科技、建广资本、智路资本等。
2025 年 1 月	美国商务部修订了《出口管理条例》，将中国 11 个实体加入实体清单，包括中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院上海光学精密机械研究所、苏州超纳精密光电技术有限公司、南京施密特光学仪器有限公司等，自 1 月 6 日起生效。 从 2025 年 1 月 2 日起，包括美国公民、持有“绿卡”的合法永久居民在内的美国人士，在美国设立的实体及其外国分支机构，以及在美国境内的任何个人或实体，都禁止投资或需要申报才能投资中国的半导体和微电子、量子信息技术以及人工智能三个行业。
2025 年 1 月	美国国防部发布最新版的“中国涉军企业”清单（根据美国法律正式规定为“第 1260H 条名单”），将腾讯控股、宁德时代、长鑫存储、长江存储、华为控股、中芯国际、奇虎 360 公司、中国移动、中国联通、中国电信、华大基因等 134 家中国企业新增列入该清单。
2025 年 1 月	美国政府推出《人工智能扩散规则》，公布对 AI 芯片出口的新限制措施，这份新规将出口目的地分为三类，美国对 18 个关键盟友与合作伙伴的芯片销售无任何限制；对中国、伊朗等实施了严格的 AI 芯片销售限制；对其他国家，大多数国家则将面临总算力限制，每个国家在 2025 年至 2027 年期间最多可获得约 5 万个 AI GPU。
2025 年 1 月	美国商务部修订了《出口管制条例》，共增加了 25 个中国实体，主要包括智谱旗下 10 个实体、算能旗下约 11 个实体，以及哈勃投资的光刻机企业科益虹源等；BIS 还更新先进计算半导体的出口管制，针对于先进逻辑集成电路是采用“16nm/14nm 节点”及以下工艺、或采用非平面晶体管架构生产的逻辑集成电路，采取更多审查和规范，并且细化了多个物项信息如 DRAM 行业 18 纳米半间距节点的生产标准等。
2025 年 5 月	美国商务部宣布废除拜登政府此前推出的《人工智能扩散规则》（AI Diffusion Rule），并同时宣布三项旨在加强海外 AI 芯片出口管制的新举措：全球禁用华为 Ascend 芯片，明确在世界任何地区使用华为 Ascend 芯片均被视为违反美国出口管制条例；限制 AI 芯片用于中国 AI 模型，若美国 AI 芯片被用于训练或干扰中国人工智能模型，相关企业将面临严重后果；供应链反制指南，要求美国企业重新审视供应链合作伙伴，强化审查机制，防范技术转移风险。

资料来源：中华人民共和国商务部官网，美国商务部官网，美国政府官网，人民网，央视网，芯智讯，日经新闻，中芯国际公司公告，半导体产业纵横，腾讯，芯榜，中原证券研究所

4. 行业动态

4.1. 全球半导体行业动态

下载日志已记录，仅供内部参考

1、美国政府考虑加码半导体关税，在美生产可豁免

2026 年 9 月 2 日消息，美国商务部长卢特尼克表示，美国政府正在考虑对进口半导体加征新一轮关税，以吸引更多芯片制造企业在美国设厂。在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时，卢特尼克提到新关税可能伴随关税减免措施，投资美国本土制造业的企业有望获得优惠，这一做法借鉴了特朗普政府对制药行业的措施。

卢特尼克解释说，如果企业在美建厂，将享受关税减免；反之则需支付关税。他认为这是一种合理且有效的方法。今年 1 月，特朗普政府曾以国家安全为由，对部分进口半导体、半导体制造设备及相关产品加征 25%的关税。8 月初，特朗普还宣布计划对进口半导体产品征收 100%的关税。

新一轮关税的范围可能扩大至含有芯片的产品，这意味着数据中心服务器和消费电子产品也可能受到影响。批评者担心这会增加在美国建设数据中心的成本，但卢特尼克认为通过向在美生产的企业提供关税优惠可以解决这一问题。他表示，未来将出台更有针对性的关税政策，鼓励企业在美生产。（中华网）

2、华为发布新一代三折叠旗舰 Mate XT 2 非凡大师及麒麟 9050 Pro 芯片

2026 年 9 月 7 日消息，华为在广州举行 HarmonyOS 7 及 Mate XDR 折叠屏新机发布会，新一代三折叠旗舰 Mate XT 2 非凡大师正式亮相。华为宣布 Mate XT2 首发搭载新一代麒麟 9050 Pro 旗舰芯片，这是继 2020 年华为 Mate40 全球发布会之后，华为时隔六年在旗舰发布会上正式推出旗舰级麒麟芯片，同时这也是首款基于华为“韬定律”、逻辑折叠技术设计麒麟芯片。

麒麟 9050 Pro 被称为“史上性能最强的芯片”，助力 Mate XT2 整机性能较上一代提升 42%以上。麒麟 9050 Pro 搭载自研灵犀九核超线程 CPU，单核峰值性能提升 24%，多核并发性能提升 52%；集成的马良 GPU 支持硬件级光线追踪，计算单元与缓存翻倍，可处理 5000 万线实时光线追踪，渲染性能飙升 142%。4K 视频导出速度提升 40%以上；达芬奇架构 NPU 实现了多尺寸大模型入端，多级存算协同优化技术。

作为麒麟 9050 Pro 的首发终端产品，华为 Mate XT 2 非凡大师采用全新展翼三折叠设计，展开厚度仅 3.5 毫米，保持业界最薄折叠屏记录。内屏 10.2 英寸 3K 大屏，外屏 6.5 英寸，峰值亮度达 6500 尼特。售价方面，16GB+256GB 版 19999 元起，顶配 16GB+1TB 灵盾防窥屏版达 24999 元，9 月 12 日正式开售。（芯智讯）

3、小米发布首款中折叠手机 18 Fold

2026 年 9 月 7 日消息，小米 2026 秋季旗舰新品发布会在北京举办，小米创始人、董事长、CEO 雷军正式发布小米首款中折叠手机 18 Fold，这款产品研发周期达 20 个月，首发搭载小米自研玄戒 O3 AI 旗舰处理器，配备 6000 毫安电池，是迄今为止最高端的小米手机。售价方面，小米 18 Fold 起售价为 10999 元/台，最高配版本 14999 元/台，陶瓷版本 15999 元/

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

台。（搜狐）

4、安森美再发涨价函

2026 年 9 月 18 日消息，近日安森美发布涨价通知，将对广泛的产品系列实施价格调整，新价格将于 2026 年 10 月 10 日起生效。今年上半年，该公司已进行过一轮调价。安森美表示，原材料、制造、能源和基础设施成本的持续上涨是本次涨价的主要原因。与此同时，过去几个季度，电源、工业和数据中心等多个应用市场的需求正在增长，公司正在进一步投资制造产能、技术以及运营韧性。（新浪）

5、长鑫科技 G5 平台宣布量产

2026 年 9 月 20 日消息，长鑫存储在世界制造业大会上宣布，第五代 DRAM 技术平台（简称“G5 平台”）实现量产，公司还同步展出了基于该平台打造的大容量 LPDDR5X 新品。

据介绍，G5 平台在关键工艺维度实现了多项行业领先的技术突破。依托创新的四重曝光技术把内存阵列的有源区半间距微缩至 11.95 纳米，接近全球最顶尖的内存量产平台制程。通过变革工艺流程、采用新材料，存储电容深宽比达 45:1。开发适配 DRAM 工艺的高介电常数金属栅（HKMG）工艺，成功将 G5 平台核心功能区高度缩小到 6762 纳米。

G5 微缩工艺的突破，推动存储密度实现跨越式提升：每片晶圆产出裸片数量较第四代平台提升至少 50%（均换算为 8Gb 颗粒基准统计），在产品能效、成本控制上均具备显著优势。

本次大会上，长鑫存储同步展出两款基于 G5 平台打造的 LPDDR5X 量产产品，单颗容量均为 24Gb，较上一代同类型产品提升 50%，分别采用 496Ball、245Ball 封装规格，可适配中高端智能手机、便携式消费电子等不同场景需求，目前均已进入规模量产阶段。

长鑫存储表示，G5 平台工艺水平比肩行业顶尖量产工艺节点，是长鑫存储在高端存储技术路线上的里程碑式突破，能够为全球存储产业提供更具创新性、更具供应链韧性的解决方案。未来，公司将持续面向全球市场需求推进技术迭代，推出更高性能、更高可靠性的存储产品，为全球数字产业发展提供坚实的底层存储支撑。（新华网）

6、海光信息发布 1000 系列 CPU

2026 年 9 月 22 日消息，海光信息在深圳举办“释放端侧算力 驱动物理世界”新品发布会，正式发布 1000 系列 CPU，这是海光首款面向工业控制等物理世界场景的芯片。

随着工业数字化持续深入，嵌入式工控设备承担的任务更加复杂。海光 1000 系列，正是面向这一需求推出。

海光信息总裁沙超群表示，算力正在从云端慢慢向边缘、端侧下沉，人工智能不仅跑在数据中心里，逐步也要走向真实的物理世界，落地到工厂、能源场点、轨道交通、医疗设备等场

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

景。此次新品发布，进一步完善了海光面向云、边、端的产品布局，为工业智能化提供新的底层计算选择。

面向物理世界复杂多样的计算需求，海光信息总裁助理、创新产品部副总经理李成表示，工业控制等终端算力场景的竞争需要在性能、功耗、安全、兼容性和长期稳定运行之间取得平衡。基于这一思路，新品围绕真实工业场景进行系统设计，重点强化四方面能力：

更安全：基于海光“内生安全”技术理念，将安全能力融入芯片底层设计，支持国密、ECC、安全处理器及硬件密码加速等能力。

更高效：集成 iGPU，支持 4K60 双路显示、主流视频编解码及多种图形接口，同时兼顾低功耗设计，可更好承接人机交互、视频处理、机器视觉等任务。

更兼容：支持 PCIe 4.0、TSN 等高速、实时互联能力，并兼容 DDR4、DDR5；依托成熟的 C86 技术和软件生态，降低操作系统、中间件、应用及外设迁移适配成本。

更可靠：强化宽温、长生命周期及持续稳定运行能力，并依托海光既有技术、供应链和生态积累，在长期供货、成本控制等方面提供保障，更好适应工业场景长期、稳定的部署需求。

目前，该产品可面向工业自动化、网络边缘、能源公用、交通运输、工业机器人等多类场景，为不同形态的终端及边缘设备提供计算支撑。（海光信息）

7、阿里巴巴发布新一代 AI 芯片真武 V900

2026 年 9 月 22 日消息，在 2026 杭州云栖大会上，阿里巴巴平头哥发布新一代训推一体 AI 芯片真武 V900，性能是真武 M890 的三倍。阿里巴巴表示，这是目前算力性能最强的中国自研 AI 芯片，可满足万亿级参数大模型的训练和推理需求。该芯片将于 2027 年第一季度量产售卖。

针对万亿级参数大模型的训练和推理场景，真武 V900 与平头哥自研网络、存储芯片可实现系统级优化。真武 V900 通过自研 ICN Switch 互联芯片连接后的超节点，具备原生内存语义和内存统一编址能力，可实现千卡全带宽高速互联。这意味着上千颗真武 V900 能像一颗“超级芯片“一样协同工作，为超大参数模型的训练和推理提供高吞吐、低延迟、高并发的算力。

2026 杭州云栖大会上，阿里发布新升级的超节点服务器，内置真武 V900、ICN Switch、磐脉智能网卡及镇岳 SSD 主控芯片，实现算、存、网全栈系统级协同，通过阿里云全新设计的智算中心网络架构，单一集群可扩展至 50 万卡规模。基于真武 M890 的超节点已大规模应用，并跑通了 Qwen3.8、Kimi K3 等超 2 万亿参数规模模型。

平头哥表示，真武系列芯片已服务超 650 家企业客户，覆盖智驾、金融、大模型、具身智能、能源、制造等千行百业，是场景应用最广的中国自研 AI 芯片之一。阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭表示：“由于平头哥芯片产品线的成熟和客户的广泛应用，平头哥 AI 芯片的年出货量将

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

大幅提升”。（新浪）

8、高通发布第六代骁龙 8 至尊版/超级至尊版

2026 年 9 月 23 日消息，高通宣布，推出第六代骁龙 8 超级至尊版（Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6）和第六代骁龙 8 至尊版（Snapdragon 8 Elite Gen 6），扩展其旗舰产品组合以赋能智能体 AI 时代和下一代旗舰移动体验。两款移动平台均为满足消费者和 OEM 合作伙伴不断演进的需求而打造，将卓越性能、终端侧智能，以及 AI、游戏、影像和连接能力方面的创新相结合，赋能下一代全新移动体验。

高通表示，第六代骁龙 8 至尊版是“全球最快移动 CPU”，采用了台积电 2nm 工艺制造，行业首个 5GHz 频率芯片；其 CPU、GPU 和 NPU 性能较上一代分别提升 13%、44%和 35%，在 3B 参数模型下，NPU 预填充速度最高提升 80%。

第六代骁龙 8 至尊版的 CPU 部分为定制版 Qualcomm Oryon，采用“2+6”二从架构，由 2 个 5GHz 的超级内核和 6 个 4GHz 的性能内核组成，加入了全新 QualcommOryon FlexCache 缓存架构；GPU 部分为全新架构的 Adreno GPU，引入全新 AI 硬件加速单元，带有 18MB 的独立高速显存（HPM），支持虚幻引擎 5 Lumen 光追效果；新 Hexagon NPU 专为智能体 AI 打造，通过高通传感器中枢提升能效表现；支持 LPDDR6 内存和 UFS 5.0 存储；全新 20-bit Qualcomm Spectra ISP，支持 64MP 三摄，实现 8K 60fps 视频拍摄和 4K 240fps 超级慢动作视频拍摄，另外还支持高级专业视频格式（APV）；配有高通 X105 基带，提供了 14.8Gbps 的 5G 下行峰值速率；支持 FastConnect 8800 移动连接系统，提供了 11.6Gbps 的 Wi-Fi 下行峰值速率。

小米、vivo、红魔、REDMI、OPPO、一加、Motorola、iQOO、荣耀等全球领先 OEM 厂商和智能手机品牌，将率先在其旗舰产品中采用第六代骁龙 8 超级至尊版和第六代骁龙 8 至尊版移动平台。（超能网，新浪）

4.2. 河南省半导体行业动态

1、郑州航空港区绘制“十五五”产业新版图

2026 年 9 月 14 日消息，河南省“开局起步'十五五'奋力谱写新篇章”系列新闻发布会航空港区专场举行。围绕“十五五”期间，航空港区将如何发挥龙头带动作用、构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，郑州航空港区科技工信局党组书记、局长齐付安亮出航空港区产业新版图。

“十四五”期间，在省委、省政府的坚强领导下，航空港区已形成以富士康、超聚变为龙头的 5000 亿级的信息产业集群，建成了比亚迪产业链最完整的千亿级新能源汽车综合基地；在这里，1 分钟下线 1 台新能源汽车、产出 1 台服务器，1 秒钟生产 6 部手机、100 个手机芯片，3 秒钟产出 1 支电池电芯，企业活力十足，产业动能澎湃。“十五五”时期，航空港区将聚焦“全省高质量发展核心增长极”这一总定位，进一步强化两新融合的引领作用和龙头企业

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

的带动作用，发力高成长赛道、布局高潜力赛道、抢占未来前沿赛道，加速提升产业能级，加快建成具有港区特点、示范引领全省的新质生产力发展先导区。

发挥龙头企业创新引领力，打造世界一流企业支撑地。坚定支持龙头企业做优做强，全力支撑行业龙头打造世界一流企业。重点推进富士康新事业板块快速落地，打造全球创新和产业布局的核心基地；全力服务比亚迪系列重大项目布局实施，加快推进国际陆港建设，畅通比亚迪陆上出口通道，建成全国最大的整车全产业链战略基地；依托空港智算中心万 P 算力底座，构建“硬件制造+算力服务”融合生态，加快超聚变 AI 智慧工厂建设，重点支持算力和算力装备产业跑出加速度。

发挥龙头企业发展带动力，打造具有全国影响力的产业集群。坚持“龙头引领、配套跟进”，吸引上下游配套和生产性服务业加速集聚，构建从“单点突破”到“生态雨林”的产业生态圈。加快推进富士康电子元器件、鑫宇光学、惠科光电、荣盛泛半导体材料等项目建设，建设全省生态最优、具有全国影响力的信息技术产业集群；加快推进比亚迪兆瓦闪充等项目建设，搭建智能网联场景，引育汽车零部件企业，建设新能源汽车智能化赛道产业新城；坚持“世界标准、国际一流”，推进“五链”融合、“五医”联动，加快推进西门电子、碧迪医疗、迈瑞医疗、三鑫医疗等生物医药大健康落地建设，着力打造全球首个中西医结合的医学科学新城。

发挥细分赛道链主企业的成长爆发力，抢滩布局未来产业。坚持科技创新和产业创新深度融合，依托高能级创新平台、百亿级产业基金和专项配套政策等体系化赋能，构建“孵化器+加速器+科技产业社区”梯次孵化体系，打造“外部研发、港区转化”的协同格局，大力培育一批科技型创新链主企业引领的细分产业。重点支持东微电子由高端靶材向 AI 芯片、光刻机核心零部件拓展，打造半导体领域的独角兽企业。精准赋能郑州合晶、郑州煜众精密、空港科锐、光力瑞弘等高成长企业，加速建设一批细分产业赛道的特色产业集群。同时以建设科技产业社区为抓手，积极抢滩脑机接口、合成生物和前沿新材料等未来产业赛道，力争“十五五”末，航空港区基本建成以先进制造业为骨干的现代化产业体系。（大河报）

5. 估值分析与投资建议

5.1. 估值分析

目前半导体行业 PE 估值高于近十年中位值及平均值。目前申万半导体行业 PE（TTM）约为 71 倍，近十年申万半导体行业 PE（TTM）最大值约为 165 倍、最小值约为 32 倍，申万半导体行业 PE（TTM）近十年中位值约为 75 倍、平均值约为 79 倍，目前半导体行业 PE 估值低于近十年平均值及近十年中位值。

下载日志已记录，仅供内部参考

图 63：近十年半导体（申万）PE Bands



资料来源：Wind，中原证券研究所（截至 2026 年 9 月 30 日）

5.2. 投资建议

近期 Muse、Dots、Instinct 等多款个人 AI 智能体陆续发布，Meta Muse 引发个人智能体应用热潮；Muse 上线后仅五天，下载量超过 ChatGPT，登顶美国 iOS 免费榜；根据 Sensor Tower 的估算，Muse 上线 22 天的下载量已突破 500 万次，同期 ChatGPT 的下载量为 230 万次。AI 智能体所需要的自主规划、多步推理、调用外部工具、连接数据库、执行代码并持续交互时，工作负载从计算密集转向控制密集、分支密集、IO 密集，GPU 负责计算，CPU 决定能否持续、高效的计算，Agentic AI 时代 CPU 重回 AI 数据中心核心。在 Advancing AI 2026 大会上，AMD CEO 苏姿丰表示，2030 年服务器 CPU 市场规模从此前 1200 亿美元上调至 2200 亿美元，2025-2030 年复合增速将超过 50%，CPU 成为 AI 基础设施的核心增量。在传统的 AI 数据中心中，CPU:GPU 比例为 1:4~1:8，智能体正驱动 CPU:GPU 比例从 1:4~1:8 转向接近 1:1，CPU 地位不断提升。AI 推理与智能体应用正重塑算力结构，CPU 重回 AI 数据中心核心，目前服务器 CPU 需求旺盛，供给紧张，有望迎来新一轮涨价潮，国产 CPU 厂商正加速实现国产替代，建议关注国产 CPU 厂商投资机会。

6. 风险提示

下游需求不及预期；

市场竞争加剧风险；

国内厂商研发进展不及预期；

国产化进度不及预期；

国际地缘政治冲突加剧风险。

本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
请阅读最后一页各项声明

下载日志已记录，仅供内部参考

行业投资评级

强于大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 涨幅 10%以上；
同步大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 涨幅－10%至 10%之间；
弱于大市：未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 跌幅 10%以上。

公司投资评级

买入：　未来 6 个月内公司相对沪深 300 涨幅 15%以上；
增持：　未来 6 个月内公司相对沪深 300 涨幅 5%至 15%；
谨慎增持：未来 6 个月内公司相对沪深 300 涨幅－10%至 5%；
减持：　未来 6 个月内公司相对沪深 300 涨幅－15%至－10%；
卖出：　未来 6 个月内公司相对沪深 300 跌幅 15%以上。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券分析师执业资格，本人任职符合监管机构相关合规要求。本人基于认真审慎的职业态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑，独立、客观的制作本报告。本报告准确的反映了本人的研究观点，本人对报告内容和观点负责，保证报告信息来源合法合规。

重要声明

中原证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告由中原证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证所含的信息不会发生任何变更。本报告中的推测、预测、评估、建议均为报告发布日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收益可能会波动，过往的业绩表现也不应当作为未来证券或投资标的表现的依据和担保。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告所含观点和建议并未考虑投资者的具体投资目标、财务状况以及特殊需求，任何时候不应视为对特定投资者关于特定证券或投资标的的推荐。

本报告具有专业性，仅供专业投资者和合格投资者参考。根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定，本报告作为资讯类服务属于低风险（R1）等级，普通投资者应在投资顾问指导下谨慎使用。

本报告版权归本公司所有，未经本公司书面授权，任何机构、个人不得刊载、转发本报告或本报告任何部分，不得以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的刊载、转发，本公司不承担任何刊载、转发责任。获得本公司书面授权的刊载、转发、引用，须在本公司允许的范围内使用，并注明报告出处、发布人、发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下简称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为其发送行为负责，提醒通过该种途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过该种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

特别声明

在合法合规的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问等各种服务。本公司资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告意见或者建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到潜在的利益冲突，勿将本报告作为投资或者其他决定的唯一信赖依据。